

01 智慧財產及商業法院民事中間判決

02 108年度民專訴字第101號

03 原 告 頤邦科技股份有限公司

04 法定代理人 吳非艱

05 訴訟代理人 李宗德律師（兼送達代收人）

06 蔡毓貞律師

07 劉昱劭律師

08 複 代 理 人 陳佩貞律師

09 施志寬律師

10 謝伯駿律師（於民國112年2月7日解除委任）

11 輔 佐 人 黃仁浩

12 被 告 易華電子股份有限公司

13 兼 上 一 人

14 法定代理人 黃嘉能

15 被 告 李宛霞

16 黃梅雪

17 蔡金保

18 夏志雄

19 林建一

20 共 同

21 訴訟代理人 黃福雄律師

22 洪郁棻律師

23 王吟吏律師

24 黃耀霆律師

25 上列當事人間請求確認專利權等（勞動）事件，本院於民國111  
26 年12月23日就營業秘密及侵權認定部分為言詞辯論終結，並為中  
27 間判決如下：

28 主 文

29 附表二編號1-1至1-3、3技術內容欄所示，為原告所有之營業秘  
30 密。

01 被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保所為申請如附表一編號1所示專  
02 利，共同侵害原告所有如附表二編號1-2技術內容欄所示之營業  
03 秘密。

04 被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保所為申請如附表一編號2所示專  
05 利，共同侵害原告所有如附表二編號1-3技術內容欄所示之營業  
06 秘密。

07 被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一所為申請如附表  
08 一編號5所示專利，共同侵害原告所有如附表二編號3技術內容欄  
09 所示之營業秘密。

10 事實及理由

11 壹、程序方面：

12 一、按各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法  
13 院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其  
14 原因為正當者，亦同，民事訴訟法第383條第1項定有明文。  
15 又關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於  
16 辯論是否成立侵害後行之，智慧財產案件審理細則第35條本  
17 文亦有明文。本院認兩造就協議為中間判決即營業秘密及侵  
18 權認定部分，因已達於可為裁判之程度，爰為中間判決，先  
19 予敘明。

20 二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之  
21 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明、不甚礙被  
22 告防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1  
23 項第2款、第3款、第7款分別定有明文。次按不變更訴訟標  
24 的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更  
25 或追加，同法第256條亦有明文。查本件原告於民國110年3  
26 月23日具狀表明民法第184條第1項前段、第185條第1項為備  
27 位請求權基礎（見本院卷四第275頁至第276頁）；又原告訴  
28 之聲明經歷次變更後，於111年11月4日具狀確認訴之聲明  
29 為：「(一)確認原告為如附表一所示專利（內容詳如附表一，  
30 下稱系爭專利甲至己）之共同申請權人。(二)被告黃嘉能、李  
31 宛霞、黃梅雪、蔡金保及夏志雄應連帶給付原告新臺幣（下

01 同) 375萬元；被告易華電子股份有限公司(下稱易華公  
02 司)、黃嘉能、李宛霞及黃梅雪應連帶給付原告375萬元，  
03 及均自108年12月12日起至清償日止，按週年利率百分之5計  
04 算之利息。如前開其中一被告已為給付，其餘被告於其給付  
05 範圍內即免除給付之義務。(三)被告黃嘉能、李宛霞、黃梅  
06 雪、蔡金保、夏志雄及林建一應連帶給付原告500萬元；被  
07 告易華公司、黃嘉能、李宛霞及黃梅雪應連帶給付原告500  
08 萬元，及均自108年12月12日起至清償日止，按週年利率百  
09 分之5計算之利息。如前開其中一被告已為給付，其餘被告  
10 於其給付範圍內即免除給付之義務。(四)被告黃嘉能、李宛  
11 霞、黃梅雪、蔡金保及林建一應連帶給付原告125萬元；被  
12 告易華公司、黃嘉能、李宛霞及黃梅雪應連帶給付原告125  
13 萬元，及均自108年12月12日起至清償日止，按週年利率百  
14 分之5計算之利息。如前開其中一被告已為給付，其餘被告  
15 於其給付範圍內即免除給付之義務。」等語(見本院卷六第  
16 342頁至第343頁)。經核原告各次所為，或係擴張、減縮請  
17 求範圍、或係補充或更正事實上或法律上之陳述，均係與本  
18 於被告侵害原告營業秘密之同一基礎事實，且不甚礙被告之  
19 防禦及訴訟之終結，於法並無不合，應予准許。

20 三、被告雖稱原告所提本件訴訟，與本院105年度民營訴字第12  
21 號民事訴訟、臺灣高雄地方法院108年度智訴字第2號刑事附  
22 帶民事訴訟，當事人與訴訟標的相同，屬於同一事件，應不  
23 得更行請求云云，並提出105年度民營訴字第12號民事起訴  
24 狀及追加狀、108年度智訴字第2號刑事附帶民事訴訟起訴狀  
25 及追加狀在卷為憑(見本院卷二第417頁至第459頁)，惟觀  
26 諸原告於上開2案中，係以被告易華公司惡意挖腳，被告李  
27 宛霞等人以不正當方法取得原告營業秘密，再集體跳槽集結  
28 為Chip On Film(即捲帶式封裝載板，或稱軟性基板，下稱  
29 COF)團隊，並將原告蝕刻技術全盤移植到易華公司，使易  
30 華公司於103年間重啟蝕刻產線且生產COF產品，影響正常交  
31 易秩序，造成原告COF出貨量減少並受有損害，與原告於本

01 件訴訟主張被告等人於107、108年間將原告營業秘密內容用  
02 以申請系爭專利甲至己，致其營業秘密對世公開，此洩漏行  
03 為使原告受有侵害，兩者侵權時間、侵權行為及原告主張受  
04 有損害之範圍均有不同，訴訟標的亦非完全相同，故非同一  
05 案件，是被告此部分所辯，難認可採。

06 貳、實體部分：

07 一、原告主張：

08 (一)原告係國內知名之電子零組件製造業者，以LCD驅動IC封裝  
09 及測試為主要營業項目；欣寶電子股份有限公司（下稱欣寶  
10 公司）係生產COF之製造廠。嗣欣寶公司於103年8月1日與原  
11 告合併，合併後原告為存續公司，欣寶公司為消滅公司，欣  
12 寶公司全部資產及權利、義務均由原告概括承受。被告易華  
13 公司亦為生產COF之製造廠商，與原告間具有直接競爭關  
14 係。

15 (二)附表二編號1至4所示之技術文件（下稱技術文件A、B、C、  
16 D，與本案相關之技術內容，詳如附表二技術內容欄所載）  
17 原為欣寶公司於100、101年間所有，其中技術文件B、C、D  
18 係欣寶公司受讓自日商三井金屬礦業株式會社（下稱MCS公  
19 司），嗣經原告於103年8月1日合併欣寶公司後，繼受欣寶  
20 公司全部權利義務即包含技術文件A、B、C、D。而該等技術  
21 文件所揭示之光罩繪製等技術，係用於使COF產品符合客戶  
22 之線路圖設計，完善製作流程及提升COF產品良率，此技術  
23 資訊非一般涉及該類資訊之人所知，且具有實際或潛在之經  
24 濟價值，又欣寶公司於制式員工聘僱契約、員工工作規則、  
25 獎懲管理辦法、MCS公司技轉之員工派外培訓協議書等相關  
26 規範保密文件，均有要求員工不得洩漏公司機密及重要資  
27 料，並負保密義務，再技術文件A、B、C、D均係集中存放於  
28 欣寶公司終端機伺服器（Terminal Server），管制使用者  
29 或應用程式或外接裝置之存取權限，欣寶公司更禁止公司員  
30 工使用外部網路及電子郵件，有業務需求之使用者，均須提  
31 出「資訊系統需求申請表」，並經主管核可始得為之，另資

01 訊單位仍會持續進行使用紀錄監控及網站瀏覽與郵件收發容  
02 量限制，是欣寶公司就技術文件A、B、C、D已採取合理之保  
03 密措施，自屬原告之營業秘密。

04 (三)原告陸續於108年8月起在經濟部智慧財產局（下稱智慧局）  
05 發現被告易華公司申請並經獲准取得系爭專利甲至己，其中  
06 系爭專利甲、乙、丙之技術特徵，與原告所有技術文件A如  
07 附表二編號1-1至1-4技術內容欄所示相同，可認對系爭專利  
08 甲請求項1、13、系爭專利乙請求項1、丙請求項1之技術特  
09 徵有實質貢獻，原告應為系爭專利甲、乙、丙之共同發明  
10 人；其中系爭專利丁、戊、己之技術特徵，則分別與原告所  
11 有技術文件B、C、D如附表二編號2至4技術內容欄所示相  
12 同，可認各對系爭專利丁請求項1、7、戊請求項1、己請  
13 求項1之技術特徵有實質貢獻，原告應為系爭專利丁、戊、己  
14 之共同發明人，故依專利法第5條第2項、第12條規定，請  
15 求確認原告為系爭專利甲至己之共同申請權人。

16 (四)被告李宛霞、黃梅雪原為欣寶公司之總經理及副總經理，於  
17 102年年中自欣寶公司離職後，即於103年7月1日受聘於被告  
18 易華公司，並分別擔任總經理、副總經理之職務；被告蔡金  
19 保、夏志雄、林建一原分別為欣寶公司之工程部部长、研  
20 發工程部部长、製程工程部部长，均為欣寶公司之高階  
21 主管，其等自102年年底自欣寶公司離職後，於103年4月1日  
22 均至被告易華公司任職，分別擔任設計部處長、研發部處  
23 長、製造工程處處長。詎被告蔡金保、黃梅雪竟於離職前分  
24 別攜走技術文件A及技術文件B、C、D，並於易華公司擔任前  
25 述職務，被告蔡金保、夏志雄、林建一即利用技術文件A、  
26 B、C、D如附表二技術內容欄所示資訊，於107、108年間陸  
27 續申請系爭專利甲至己，且分別於系爭專利甲至己列名為專  
28 利之發明人或創作人（詳如附表一所示）。又被告李宛霞、  
29 黃梅雪明知該等技術來源屬於原告所有，仍與擔任易華公司  
30 董事長之被告黃嘉能批准申請上開專利而獲准取得，將原告  
31 上開營業秘密以專利登記公示方式對世公開而為洩漏行為，

01 且使原告前述營業秘密喪失秘密性，是其等所為均屬營業秘  
02 密法第10條第1項第2款侵害營業秘密之行為，被告蔡金保尚  
03 涉及營業秘密法第10條第1項第4款侵害行為，並均侵害原告  
04 就上開專利之專利申請權，故被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪  
05 與系爭專利甲至己列名之發明人或創作人為共同侵權行為  
06 人，爰依營業秘密法第12條第1項、民法第184條第1項前  
07 段、第185條第1項規定，請求被告蔡金保、夏志雄、黃嘉  
08 能、李宛霞、黃梅雪就申請系爭專利甲請求項1、13、系爭  
09 專利己請求項1部分；被告蔡金保、夏志雄、林建一、黃嘉  
10 能、李宛霞、黃梅雪就申請系爭專利乙請求項1、系爭專利  
11 丁請求項1、7、系爭專利戊請求項1部分；被告蔡金保、林  
12 建一、黃嘉能、李宛霞、黃梅雪就申請系爭專利丙請求項1  
13 部分，共同連帶負損害賠償責任。另被告易華公司應依民法  
14 第28條、公司法第23條第2項規定，就擔任公司代表人、負  
15 責人於執行職務申請專利權侵害原告營業秘密部分，與被告  
16 黃嘉能、李宛霞、黃梅雪連帶負擔損害賠償責任。

17 (五)並聲明：

- 18 1. 確認原告為系爭專利甲至己之共同申請權人。
- 19 2. 被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄應連帶給付  
20 原告375萬元；被告易華公司、黃嘉能、李宛霞、黃梅雪應  
21 連帶給付原告375萬元，及均自108年12月12日起至清償日止  
22 按週年利率百分之5計算之利息。如前開其中一被告已為給  
23 付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務。
- 24 3. 被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一應  
25 連帶給付原告500萬元；被告易華公司、黃嘉能、李宛霞、  
26 黃梅雪應連帶給付原告500萬元，及均自108年12月12日起至  
27 清償日止按週年利率百分之5計算之利息。如前開其中一被  
28 告已為給付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務。
- 29 4. 被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡金保、林建一應連帶給付  
30 原告125萬元；被告易華公司、黃嘉能、李宛霞、黃梅雪應  
31 連帶給付原告125萬元，及均自108年12月12日起至清償日止

01 按週年利率百分之5計算之利息。如前開其中一被告已為給  
02 付，其餘被告於其給付範圍內即免除給付之義務。

03 二、被告則以：

04 (一)原告並未舉證其自MCS公司架構受讓技術文件B、C、D，且原  
05 告於106年12月起陸續將技術文件B、C、D移轉處分予訴外人  
06 中國合肥奕斯偉材料科技有限公司（下稱奕斯偉公司），是  
07 原告於系爭專利公開期日即108年6月21日至同年10月1日期  
08 間，是否為上開技術文件之所有人，已有可疑，則原告請求  
09 確認其為系爭專利甲至己之共同申請權人，應無確認利益。

10 (二)技術文件A、C之光罩線路補償資訊僅係所屬相關產業之從業  
11 人員依固有知識及工作積累經驗，經邏輯分析、推理或試驗  
12 而可輕易思及之光罩補償原理原則，其中技術文件A所揭示  
13 虛墊（Dummy Pad）結構更外顯於產品外觀；技術文件B、D  
14 所揭示對位孔設計及緩合應力之路線設計，則係IC設計公司  
15 設計，經COF廠製造後，將可見於市場流通之COF產品之外  
16 觀；技術文件D所載緩合應力資訊，更早已揭露於封裝廠STE  
17 CO公司編寫之「COF FILM共通規格書」，屬相關技術領域習  
18 知技術。又技術文件B、C、D均非原告支付金錢對價向MCS公  
19 司購得，不具秘密性與實際或潛在之經濟價值，且原告於合  
20 併欣寶公司前，欣寶公司對於文件管理並無分級管理，嗣原  
21 告於102年間取得欣寶公司百分之百股份後，欣寶公司方於  
22 同年10月9日發布文件等級管理辦法，顯晚於被告李宛霞、  
23 黃梅雪同年6月25日自欣寶公司離職前，而被告蔡金保、夏  
24 志雄及林建一於同年底離職前，技術文件A、B、C、D均未經  
25 列為機密文件，欣寶公司斯時仍未建立相關文件管制措施  
26 （如權限區分限制或文件存放之伺服器隔離等）或網路瀏覽  
27 限制，欣寶公司需使用電腦作業之員工均可透過終端機伺服  
28 器自由對外使用網際網路所有服務，存取欣寶公司資料，再  
29 欣寶公司更提供員工得以虛擬私人網路（VPN）方式自公司  
30 外部連線存取資料，或有提供公用筆記型電腦便利員工以VP  
31 N連線存取資料，或設置公用電腦便利員工以USB方式存取資

01 料，至終端伺服器本身具資訊存取與網路連結管制功能，仍  
02 應視管理者本身是否及如何使用，並非當然啟用。況被告李  
03 宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄及林建一就技術文件A、B、  
04 C、D均無與欣寶公司簽立相關保密契約，故技術文件A、B、  
05 C、D均非屬營業秘密。

06 (三)縱認技術文件A、B、C、D為營業秘密，該等技術文件並未揭  
07 露系爭專利甲至己相關技術特徵，與被告易華公司製程亦不  
08 相容，被告等並無任何不法侵害原告營業秘密之情事，原告  
09 亦未舉證證明之。又縱認被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏  
10 志雄及林建一有將技術文件A、B、C、D如附表二技術內容欄  
11 所示資訊攜至被告易華公司，或有接觸該等文件等情，惟該  
12 等技術文件內容因已經公開，而不具秘密性，是原告無從再  
13 以系爭專利之申請行為，主張技術文件A、B、C、D因公開而  
14 受有侵害。

15 (四)並聲明：

- 16 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。
- 17 2.若受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
- 18 3.訴訟費用由原告負擔。

19 三、本院整理兩造不爭執事項（見本院卷二第193頁至第194頁，  
20 並依判決格式修正或刪減文句）：

21 (一)被告李宛霞、黃梅雪原分別為欣寶公司（欣寶公司於103年8  
22 月1日合併於原告）之總經理及副總經理，於102年年中自欣  
23 寶公司離職後，於103年7月1日受聘於被告易華公司，分別  
24 擔任被告易華公司總經理及副總經理職務。被告蔡金保（原  
25 欣寶公司設計工程部部經理）、夏志雄（原欣寶公司研發工  
26 程部部經理）、林建一（原欣寶公司製程工程部部經理），  
27 前均為欣寶公司高階主管，渠等於102年年底自欣寶公司離  
28 職，於103年4月1日至被告易華公司擔任相當之職務。

29 (二)被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一等人涉嫌違  
30 反營業秘密法案件經臺灣高雄地方檢察署提起公訴（案號：  
31 105年度偵字第22514號、107年度偵字第8952號），現由臺



01 灣高雄地方法院審理中（案號：108年度智訴字第2號，下稱  
02 刑案）。

03 (三)被告易華公司於107年至108年間陸續向智慧局申請並經核准  
04 取得系爭專利甲至己之專利權。被告蔡金保、夏志雄、林建  
05 一分別如附表一所示為系爭專利甲至己之發明人或創作人。

06 四、得心證理由：

07 (一)技術文件A、B、C、D（如附表二各編號技術內容欄所示資  
08 訊）是否為原告所有之營業秘密：

09 1.原告主張技術文件A為被告蔡金保任職於欣寶公司時所製  
10 作，技術文件B、C、D為欣寶公司於100年至101年間向MCS公  
11 司所價購取得，又欣寶公司嗣後為原告所併購，故技術文件  
12 A、B、C、D為原告所有等情，被告固不否認技術文件A為被  
13 告蔡金保任職於欣寶公司時所製作，而為原告併購取得，且  
14 技術文件B、C、D原屬MCS公司所有之事實，然辯稱：原告並  
15 未舉證證明其向MCS公司購置技術內容包含技術文件B、C、  
16 D，又原告已將該等技術文件移轉給奕斯偉公司，自非技術  
17 文件B、C、D之所有人云云。經查，欣寶公司與MCS公司於10  
18 0年12月26日簽立移轉交易合約，約定欣寶公司以買賣方式  
19 取得MCS公司所有產製COF產品設備，及MCS公司應轉讓或授  
20 權為使用第二代G2新蝕刻製程以產製COF產品所必要之技術  
21 與欣寶公司，並於附件中記載待轉讓或授權之技術是關於新  
22 蝕刻G2製程及產製COF產品檢測之技術，包含新蝕刻G2製程  
23 及COF設計規則，為小於25微米的細間COF圖案而開發之蝕刻  
24 製程；製造COF用的AOI相關設備及操作標準；製造COF用的  
25 多重線路EI相關設備及操作標準；製造COF多重線路AVI相關  
26 設備及操作標準，且本技術相關專利、專利申請案、有關之  
27 專有知識均應於102年3月31日前轉讓與欣寶公司，有欣寶公  
28 司與MCS公司簽署移轉交易合約、交割聲明及中譯本節本等  
29 件在卷可稽（見本院卷二第271頁至第301頁、本院卷四第47  
30 5頁至第482頁），復觀諸技術文件B、C、D內容（見限閱卷  
31 一第59頁至第66頁、第81頁至第97頁、第131頁至第136

頁) ,均係關於新蝕刻G2製程及產製COF產品檢測之相關設計規則等技術資料,又依前述合約內容,可知欣寶公司自MCS公司取得於新蝕刻G2製程及產製COF產品檢測之技術,不限於該等技術之專利、專利申請案,更包含該等技術所有之專有知識內容等,並參以技術文件B、C、D之技術內容包含新蝕刻G2製程及COF設計規則(如附表二編號2至4所載),足認欣寶公司向MCS公司依前述交易合約價購取得之技術確包含技術文件B、C、D。被告徒以技術文件B、C、D非於交割聲明為標的為由否認前情,並無提出其他事證以茲證明,實非可取。另被告所提出新聞報導(見限閱卷一第193頁),雖記載「頡邦也決定與合肥地方政府基金及京東方集團合資成立COF基板廠,頡邦將取得新公司3成股權,並將把2013年併購的COF基板廠欣寶當初向日本三井金屬取得的技術及生產線移轉到新公司,台灣會保留自行研發的COF技術及產能」等語,姑不論該報導內容真實性,縱為真實,亦僅為原告未來可能之公司決策,而非可證明原告已將技術文件B、C、D移轉於奕斯偉公司之事實,況奕斯偉公司於本件訴訟中復出具說明書,表示其未自原告受讓技術文件B、C、D,此有上述說明書1份在卷為憑(見本院卷二第493頁),是被告此部分所辯,實非可採。基此,技術文件A、B、C、D(如附表二技術內容欄所示資訊)原均為欣寶公司所有,復因欣寶公司於103年8月1日與原告合併,合併後原告為存續公司,欣寶公司為消滅公司,欣寶公司全部資產及權利、義務均由原告概括承受,是技術文件A、B、C、D(如附表二各編號技術內容欄所示資訊)均為原告所有。

- 2.按營業秘密法所稱營業秘密,係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊,而符合左列要件者:1.非一般涉及該類資訊之人所知者。2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。3.所有人已採取合理之保密措施者,營業秘密法第2條定有明文。營業秘密之要件有秘密性、經濟價值及保密措施,當營業秘密所有人主

01 張其營業秘密遭第三人侵害時而請求損害賠償，通常應證明  
02 具備營業秘密要件之事實。而營業秘密要件之判斷次序，應  
03 先就主張為營業秘密之客體或標的，判斷是否有秘密性；繼  
04 認定是否具有經濟價值；最後以主觀上有管理秘密之意思與  
05 客觀上管理秘密之狀態，以審究所有人是否盡合理之保密措  
06 施。以下就原告主張技術文件A、B、C、D如附表二各編號技  
07 術內容欄所示資訊，是否具備上開營業秘密三要件分別論  
08 之。茲查：

09 (1)技術文件A、C如附表二編號1-1至1-3、3技術內容欄所示資  
10 訊，具秘密性：

11 ①所謂「秘密性」，係採「業界標準」，也就是說，除了須一  
12 般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉，始符合  
13 秘密性要件。此要件自應由營業秘密所有人負舉證責任，如  
14 其已盡舉證責任，而對造否認上情，自應由對造就此利己之  
15 事實，即該等資訊「已為涉及該類資訊之人所知」一事，負  
16 舉證之責。

17 ②查技術文件A「設計工程部CAD/CAM組底片補償程式」所揭示  
18 之內容，係針對欣寶公司當時第三代蝕刻產線（Enhanced N  
19 ew Etching, ET3）而記載各式各樣光罩補償規則與參數，  
20 以使經蝕刻後最終產出之COF產品符合客戶即IC設計公司原  
21 始線路圖案。依技術文件A如附表二編號1-1至1-3技術內容  
22 欄所示資訊，可知前開技術內容已揭露○000 000○○○○000  
23 0 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
24 ○○○000000○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
25 ○○○○○○○0000○○○○○○○○○○000000 0000○○○○○  
26 等，並據此訂定不同補償規則（見限閱卷一第7頁至第12  
27 頁），觀以該等補償內容，可知記載包含○○○00000○、  
28 ○○○○00000○○○○○○00000○，且具體指出○000 000  
29 ○○○0000 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
30 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○000  
31 000 00000000000 00 ○○○000000 ○○○○○○○○○○○○○

01 ○○○000000000 000000000○○○○○○○○○○○○○○○  
 02 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 03 000000000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○；又  
 04 指出光罩線路圖案之周圍需做補償○○○○○○○○○○○○○  
 05 ○○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 06 ○○○000000000000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 07 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，是技術文件A  
 10 如附表二編號1-1至1-3技術內容欄所示資訊，業已揭露需進  
 11 行補償之圖樣情況，並就特定區域設定不同補償規則，而該  
 12 等補償條件、規則或參數為欣寶公司長久以來依COF線路圖  
 13 案轉換成光罩圖所得之經驗，且前述外擴部線路補償量及條  
 14 件等資訊並非為一般涉及該領域之人所能知悉，應具秘密  
 15 性。

16 ③查技術文件C文件標題為「COF New Etching-G2 Photo Mask  
 17 Design Rule」，依其內容記載各式各樣的補償規則○○○  
 18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、參數○○○○○○00000○○○  
 19 ○000○與位置○○○○○○○○00000 0000○00○○○，供光罩線  
 20 路的設計人員參照使用。而依技術文件C如附表二編號3技術  
 21 內容欄所示資訊，可知該技術內容已揭露○○○○○○○○○○○○○○  
 22 0 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 23 0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 25 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 26 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
 27 ○○○0000000 ○000000 ○○○○○○○○○00000○○○○○○○○○  
 28 0000 ○○○○○○（見限閱卷一第81頁、第84頁至第86  
 29 頁），可徵技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊，  
 30 已具體說○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等資訊，而  
 31 該等補償條件及規則為MCS公司長久以來依COF線路圖案轉換

01 成光罩圖所得之經驗，並非為一般涉及該領域之人所能知  
02 悉，應具秘密性。

03 ④被告雖抗辯：技術文件A如附表二編號1-1至1-3、技術文件C  
04 如附表二編號3技術內容欄所示資訊，均係關於蝕刻製程下  
05 之光罩線路補償，從業人員依固有知識及工作積累經驗即可  
06 知該補償原理及具體參數，市場上亦有內建線路補償機制之  
07 CAD/CAM軟體可供選購利用，並揭示該等補償方法。又利用  
08 光罩線路補償、預先彌補線寬於蝕刻製程中之損失，乃業界  
09 常態作法，經由邏輯分析、推理或試驗而可輕易思及，故該  
10 等資訊不具秘密性云云。然查：

11 ①觀諸被告所提技術文件A如附表二編號1-1至1-3技術內容欄  
12 所示資訊不具秘密性之證據資料（見限閱卷四第39頁至第14  
13 6頁），其中高密度印刷電路板技術、電路板影像轉移技術  
14 等書籍資料，僅揭示利用CAD/CAM等電腦軟體輔助製造底片  
15 上線路調整、修改，而未涉及任何線路補償；西元2003年4  
16 月1日版Stella Fine Vision for JAVA產品說明書，關於  
17 「Distance Offset（間距補償）」之內容僅揭示線路大接  
18 小補償，並未揭示具體條件及補償參數，又上開說明書關於  
19 「Paraline（平行線）」之內容所記載「Stella Vision fo  
20 r JAVA配備有改變平行線轉角形狀的指令、增加或移除平行  
21 線轉角的指令、連接平行線指令」等語、日本第4104574號  
22 發明專利書公告本之圖2所揭示「方形轉角處之邊緣片段補  
23 償」、日本特開2008-159678號專利案說明書公開本之圖4所  
24 揭示「將方形轉角導為圓角」，西元2007年5月25日版Stell  
25 a Fine Vision for JAVA概要說明書所揭示「就導線架之  
26 前端進行補償」，日本特開平9-128430號專利案說明書公開  
27 本之圖11所揭示「補償線路前端部分之形狀」，美國2007/0  
28 034596號專利案說明書公開本之圖9、圖10所揭示「補償線  
29 路前端部分之形狀及預訂之線路圖案」，經比對技術文件A  
30 如附表二編號1-1至1-3技術內容所載資訊，該等資訊所顯示  
31 技術特徵在於○○○

01 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，與被告所提上開各  
02 證據所揭示之內容，兩者就光罩線路補償條件、形狀、參數  
03 等均有不同；另被告所提出之Stella Vision for JAVA 軟  
04 體其中「蝕刻因子-3」功能之操作說明頁面，除未揭示具體  
05 補償數值，亦未顯示如技術文件A如附表二編號1-1至1-3技  
06 術內容欄所示資訊，且被告提出上開頁面所呈現之圖形，實  
07 為被告事後經過自行調整數值後所得結果，已難據此而為原  
08 告不利之認定，是本院即無從依被告所提出上揭證據資料，  
09 而認技術文件A如附表二編號1-1至1-3技術內容所示資訊不  
10 具秘密性。

11 ②查依技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊，可知該  
12 內容○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，而觀諸被  
13 告所提技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊不具秘  
14 密性之證據資料（見限閱卷四第53頁至第61頁、第297頁至  
15 第378頁），其中西元2003年4月1日版Stella Fine Vision  
16 for JAVA產品說明書關於「Distance Offset」項目，其範  
17 例所揭露形成之間寬補償係全線路加寬，以及Stella軟體內  
18 建關於「Snick of Edge」之操作說明頁面所揭示將末端修  
19 飾成尖角形狀之線路，該等證據資料均未揭示○○○○○○○  
20 ○○○○○○○○○○○○之技術特徵，且經比對後，與技術文  
21 件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊實有不同。又美國第  
22 5546225號專利說明書之圖4，雖有揭示對長引腳之補償方法  
23 （見限閱卷四第303頁），然該補償方式是將長引腳超出短  
24 引寬加寬，而得出端部為圓弧型之結果，且該資料無明確具  
25 體參數可資參考，仍與技術文件C如附表二編號3技術內容欄  
26 已揭示○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
27 ○○○○有別。是被告所提出證據資料，並無從認定技術文  
28 件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊不具秘密性。

29 ③再者，線路補償規則之補償方式與補償數值，須相關技術領  
30 域之人經長期人力、物力投入研究，雖彌補蝕刻製程中損失  
31 之線寬為業界常態作法，尚不至於獲得完全相同之補償方式

01 與補償數值。又涉及該技術領域之人雖了解化學蝕刻製程在  
02 特定線路疏密程度或轉折區域，易發生側蝕或過度蝕刻現象，  
03 故利用光罩線路補償方式，預先彌補線寬於蝕刻製程中  
04 之損失，然線路補償方法眾多，對於各種情況之線路圖案所  
05 採取之補償條件規則與參數不盡相同，觀諸技術文件A所揭  
06 示之技術內容，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
07 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
11 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
12 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
13 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
14 所示，已明確記載○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
15 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
16 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
20 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
21 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
22 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
23 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
25 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
26 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
27 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
28 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
29 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
30 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

(2)技術文件A、B、D（如附表二編號1-4、2、4技術內容欄所示  
資訊），不具秘密性：

①原告雖主張技術文件A如附表二編號1-4技術內容欄所揭示之  
虛墊，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○為其營業秘密等情。查依技術文件A如附表二編號1-4  
技術內容欄所示資訊，可知其所揭露之○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 ○○○○○○○○○○○○，此觀諸聯詠科技股份有限公司「NT  
02 7701」產品型錄內所載之產品封裝資訊圖可明（見限閱卷四  
03 第185頁），又縱原告依實際生產經驗為最佳化產品結構而  
04 變更上開虛墊設計，惟該虛墊之結構在軟性電路板產品中，  
05 自產品外觀即得以直接觀之虛墊形狀，已難認符合秘密性之  
06 要件。再由我國96年2月21日公告第I274307號「電子模組、  
07 該製造方法及驅動方法以及電子機器」發明專利，其中圖式  
08 （第4圖）內容已揭示虛墊圖案之貫通孔，有該專利之專利  
09 公報及說明書公告本在卷可查（見限閱卷四第191頁至第264  
10 頁），可證原告前所主張○○○○○○○○○○技術內容，早  
11 為上開專利文件所公開。基此，技術文件A如附表二編號1-4  
12 技術內容欄所示之資訊，並不具秘密性，則原告此部分主  
13 張，洵非可採。

14 ②原告復主張技術文件B如附表二編號2技術內容欄所示之資  
15 訊，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
16 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
17 0○○○○○○○○○○○，為其營業秘密等情。觀諸技術文件B  
18 如附表二編號2技術內容欄所示資訊，該圖式僅揭示○○○  
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，然其內容並無教示對位孔  
20 中心可與斜向電路中心線上某一處向下（Y方向）或向左/右  
21 （X方向）之延伸線重合等技術內容。又參以晶強電子股份  
22 有限公司（下稱晶強公司）Design Guide for Tape、奇景  
23 光電股份有限公司（下稱奇景光公司）TCP&COF Tape品質檢  
24 驗作業指導書（見限閱卷一第207頁至第237頁），該等資料  
25 為IC設計公司委託製造COF產品時，會一併規範設計指導書  
26 與產製COF產品廠商（如原告、易華公司等），要求廠商依  
27 其設計之線路圖案及指導書生產COF產品，而其中Design Ru  
28 le of Alignment Mark、COF structure圖式（見限閱卷一  
29 第210頁、第216頁、第224頁），均已揭露原告此部分主張  
30 之對位孔設計，實難認技術文件B如附表二編號2技術內容欄  
31 所示之兩圓形對位記號，為一般涉及該類資訊之人所不知。



01 況晶門科技型號「SSD1820A」、「SSD1303」產品型錄中之  
02 產品封裝資訊圖（見本院卷四第461頁、限閱卷四第273  
03 頁），分別揭示標記中心與斜向電路中心線上某一處向X方  
04 向延伸線重合、標記中心與斜向電路中心線上某一處向X方  
05 向及Y方向延伸線重合等技術內容；我國95年10月1日公告第  
06 I263348號「用於封裝之捲帶」發明專利亦於圖式揭露軟性  
07 電路板上之SR對位孔標記（見限閱卷四第280頁），均符合  
08 原告所主張○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
09 ○○○○之情形，是技術文件B如附表二編號2技術內容欄所  
10 示之資訊，已為前述產品型錄、專利文獻所揭露，自不具秘  
11 密性。綜此，技術文件B如附表二編號2技術內容欄所示之資  
12 訊，不具秘密性，則原告此部分主張，仍非可取。

13 ③原告又主張技術文件D如附表二編號4技術內容欄所示之資  
14 訊，為其營業秘密等情。查依該資訊係於技術文件D中「產  
15 品設計基準」所涵蓋，並記載○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
16 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
18 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
19 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
20 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
21 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
22 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
23 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
24 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
25 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
26 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
27 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
28 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
29 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
30 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0  
31 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 0

然觀諸韓廠STECO公司101年提供住礦電子股份有限公司（下稱住礦公司）之「COF FILM共通規格書」、韓廠STECO公司96年間發行之「COF Design Guide」，分別揭露圖式與變更修改之技術內容（見限閱卷一第264頁、第292頁），與技術文件D如附表二編號4技術內容欄所示之資訊幾盡完全相同；復依日本公告之第3311675號「薄膜載體捲帶」發明專利（見限閱卷四第379頁至第387頁），其圖式與該說明書第【0008】段所載「內引腳側的線寬為34 $\mu$ m以下，外引腳側的線寬為90 $\mu$ m以上，該連結部的線路長度未滿100 $\mu$ m的線路上設置切口部，以解決內外引腳連結部位之應力集中問題」等內容，亦已揭露技術文件D如附表二編號4技術內容欄所示之兩種不同線路圖案及修改方法等，顯見一般涉及該類技術領域之人應已熟悉轉折線路圖案之修改原

01 則。再者，上開「COF FILM共通規格書」及日本發明專利，  
02 既已分別揭示細線寬 $30\mu\text{m}$ 以下，及細線寬 $34\mu\text{m}$ 以下、粗線  
03 寬 $90\mu\text{m}$ 以上之修改方式，縱與技術文件D前揭資訊所揭示之  
04 數值範圍有所不同，惟按營業秘密法之秘密性判斷，僅要求  
05 相對新穎性，即係採業界標準，除一般公眾所不知者外，相  
06 關專業領域中之人亦不知悉者，始有秘密性，與專利法所  
07 要求發明創作在申請專利前未見於刊物、未公開實施或未為公  
08 眾所知悉者之絕對新穎性不同，是兩者均係於轉折線路面臨  
09 不同間距線路連接之類型，解決問題之原則亦相同之情況  
10 下，該技術所屬專業領域具有通常知識者自得依其經驗，透  
11 過邏輯分析推理或試驗，獲知適當之具體補償參數及規則。  
12 綜前，技術文件D如附表二編號4技術內容欄所示資訊，應為  
13 一般涉及該類技術領域者所得知悉，而不具秘密性，是原告  
14 此部分主張，即非可採。

15 ④至原告雖爭執晶強公司Design Guide for Tape、奇景光公  
16 司TCP&COF Tape品質檢驗作業指導書、韓廠STECO公司之COF  
17 FILM共通規格書等文書真正，並認該等文件不得證明被告知  
18 悉該技術內容云云，然依證人鄭佩芬於本院審理時具結證  
19 稱：我於96年起任職於住礦公司迄今，住礦公司於103年改  
20 名及組織變更為被告易華公司，我隸屬於製程技術部，工作  
21 內容為圖面審查、設計、修改及幫客戶Layout（繪製成有線  
22 路之COF產品）、光罩補償，還有對公司內、外之溝通，線  
23 上規格如有問題，我也會協助解決。我在96年間任職於住礦  
24 公司時就看過上開文件，分別由晶強公司、奇景光公司、ST  
25 ECO公司所提供，住礦公司當時跟韓國封裝廠STECO公司有合  
26 作製作COF產品，上開「COF FILM共通規格書」內容包含圖  
27 面規格跟檢驗包裝規範，我在住礦公司審圖時有看過這份規  
28 格書，雖然是韓文，但裡面有相對應的圖示跟規格，專業術  
29 語也是使用英文，基本上的規格我都看得懂，故前2個文件  
30 是我進入住礦公司時就已經存在公司電腦內，而STECO公司  
31 之COF FILM共通規格書，是我任職住礦公司期間參與且實質

01 接觸之文件，文件顯示日期101年5月26日，應是我實際參與  
02 的時間。又被告所提出該等文件資料，均係我於舊的住礦公  
03 司伺服器搜尋後，在我之前日本主管「Yanagisawa」（中譯  
04 柳澤康裕）資料夾內所找出，我亦有該等資料於電腦內路徑  
05 畫面截圖，至於修改日期不同部分，製程技術部有專門的伺  
06 服器，我們主管存檔時他會分成很多個資料夾，資料夾項下  
07 又會分成很多個子資料夾，所以有些檔案在存的時候會存到  
08 子資料夾或存到子資料夾的子資料夾，故有重複情形，我係  
09 以輸入關鍵字去搜尋上開資料，有些找到單筆，有些找到多  
10 筆，但我有點進去看資料是不是我要的，經我點開確認後再  
11 做截圖，SETCO公司之「COF FILM共通規格書」部分所截圖  
12 兩種路徑，都可以找到該資料。另因同一客戶之產品可能要  
13 給不同的COF廠作業，當規格有出入的時候，客戶會把我們  
14 或者他廠之DESIGN GUIDE互相分享，所以我知道客戶會把住  
15 礦公司的DESIGN GUIDE文件提供給同業或者是上下游廠商等  
16 語（見本院卷六第13頁至第25頁），並有上開文件之電腦路  
17 徑網頁截圖在卷可查（見本院卷四第405頁、第409頁、第41  
18 5頁、限閱卷一第239頁），足見該等文件確實均原為住礦公  
19 司所有，並經存放於公司電腦伺服器內，而為被告及相關技  
20 術領域者所得知悉。此外，原告就前述主張內容均無提出相  
21 關證據資料以實其說，自無足採。

22 (3)因技術文件A、C如附表二編號1-1至1-3、3技術內容欄所示  
23 資訊，具有秘密性；其餘技術文件A、B、D如附表二編號1-  
24 4、2、4技術內容欄所示資訊，不具秘密性，故以下僅就技  
25 術文件A、C如附表二編號1-1至1-3、3技術內容欄所示資  
26 訊，進一步討論營業秘密之其他要件，即是否具「經濟價  
27 值」及有無「合理保密措施」，論述如下：

28 ①所謂經濟價值，係指某項資訊經過時間、勞力、成本之投入  
29 所獲得，在使用上不必依附於其他資訊而獨立存在，除帶來  
30 有形之金錢收入，尚包括市占率、研發能力、業界領先時間  
31 等經濟利益或競爭優勢者而言。他人擅自取得、使用或洩漏

01 之，足以造成秘密所有人經濟利益之損失或競爭優勢之削減  
02 (最高法院107年度台上字第2950號刑事判決)。經濟價值  
03 不只包含實際經濟價值，尚包含潛在經濟價值，如取得其他  
04 競爭者之營業秘密，而得以節省學習時間或減少錯誤，以減  
05 省試錯成本，仍具有潛在經濟價值。查技術文件A、C如附表  
06 二編號1-1至1-3、3技術內容欄所示資訊包含原告就COF製程  
07 相關技術秘密，原告透過該所屬技術領域之人員經長期經驗  
08 累積及投入實驗研究，使其獲得蝕刻製程相關補償方式、數  
09 值等資訊，而在市場上取得相當競爭地位，若競爭對手取得  
10 該等資訊，將得以掌握原告之光罩線路補償資訊，縮短研究  
11 時間及成本，並與原告競爭相同產品之客戶，足以造成原告  
12 經濟利益之損失、削減其競爭優勢，是該等資訊自具「經濟  
13 價值」。

14 ②所謂「合理保密措施」，係指秘密所有人主觀上有保護之意  
15 願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當  
16 成秘密加以保守之意思。所有人所採取之保密措施必須「有  
17 效」，方能維護其資訊之秘密性，惟並不要求須達「滴水不  
18 漏」之程度，只需所有人按其人力、財力，依其資訊性質，  
19 以社會通常所可能之方法或技術，將不被該專業領域知悉之  
20 情報資訊，以不易被任意接觸之方式予以控管，而能達到保  
21 密之目的，即符合「合理保密措施」之要求，例如：對接觸  
22 該營業秘密者加以管制、於文件上標明「機密」或「限閱」  
23 等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全  
24 措施（如限制訪客接近存放機密處所）等綜合判斷之。經  
25 查：

26 ①原告主張欣寶公司設有終端機伺服器集中管理電子檔案，並  
27 透過配發員工個人專屬帳號、密碼，按員工職級設定不同存  
28 取權限之方式管制機密文件，又技術文件A與技術文件B、  
29 C、D分別存放於公司內部電腦終端伺服器之設計部專用資料  
30 夾、MCS專用資料夾等情，業據其提出欣寶公司資料管控電  
31 腦畫面截圖、系統使用管理作業、欣寶公司Terminal Solut

01 ion系統架構說明、資訊系統需求申請表、技術文件B、C、D  
02 存放於MCS專用資料夾路徑截圖、欣寶公司資訊系統二期專  
03 案買賣合約書等件在卷為憑（見本院卷一第213頁至第226  
04 頁、本院卷二第55頁至第78頁、第495頁至第499頁、本院卷  
05 三第199頁至第219頁）；且查蘇盈君係於97年3月至102年4  
06 月任職於欣寶公司，並擔任設計工程部CAD設計師之身分，  
07 當時負責繪製COF產品之光罩圖之業務範圍，是其對於相關  
08 技術文件存放位置自應知悉甚詳，而依其所出具之說明書內  
09 容（見本院卷二第97頁），可知技術文件A電子檔案存放於  
10 設計工程部之部門專用資料夾，只有設計工程部人員得以存  
11 取之事實；再觀諸原告提出還原磁帶操作過程之公證書（見  
12 本院卷五第437頁至第568頁），亦見技術文件A、B、C、D當  
13 時存放於欣寶公司伺服器中並設有存取權限，其中技術文件  
14 A存放於【CAD設計部（專用）】資料夾，設有24名有權限存  
15 取人員；技術文件B存放於【5-4-設備技術Gr（MCS設備圖面  
16 for Layout-廠務）-勇哥】資料夾，設有21名有權限存取人  
17 員；技術文件C、D存放於【5-3-設計技術Gr（CAD設計相  
18 關）-保哥】資料夾，設有13名有權限存取人員；併參酌被  
19 告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一於任職欣寶公  
20 司時，均至日本MCS公司為相關技術轉移受訓，且經欣寶公  
21 司寄發員工派外培訓協議書給該等被告，有101年1月16日電  
22 子郵件及所附員工派外培訓協議書等件在卷可查（見本院卷  
23 五第245頁至第247頁），而依協議書協定內容所載，員工應  
24 保證遵守保密合約不將培訓所獲得之各項資訊，例如圖說、  
25 技術、文件等外流或提供予非主管授權人員等語，益徵欣寶  
26 公司當時確實將自MCS公司價購取得之技術移轉內容視為秘  
27 密，且對於被告等派外接受技術移轉員工要求簽立前開協議  
28 書，約定其等不得將該等資訊外流或洩漏他人。是原告主張  
29 有為前開保密措施等情，尚非無據。

30 ②再者，證人孫安勇於刑案偵查中、審理時均證稱：我於92年  
31 間欣寶公司建廠至原告合併迄今均在欣寶公司工作，擔任資

01 訊部經理，欣寶公司92年間建廠時，李宛霞就跟我說要比照  
02 亞洲微電模式做資訊管控，希望建置終端機伺服器系統環境，  
03 直到93年後期到104年間開始執行建置終端機伺服器之任  
04 務，設置該系統主要目的是軟體與檔案資料要集中由公司控  
05 管，且要把USB關閉，不要讓資料外洩，我們有做到集中軟  
06 體控管與USB裝置控管，以避免資料自USB外洩。欣寶公司於  
07 95年8月施行系統使用管理作業，也禁止員工使用USB隨身碟  
08 存取電腦資料，只有員工有公務需求，例如向客戶簡報，才  
09 會向資訊部門申請權限，並經高階主管即李宛霞、黃梅雪核  
10 可後，也要經過我的同意，再交由資訊部門工程師開放權  
11 限，且範圍亦針對公務使用。員工進入欣寶公司後，都要提  
12 出申請終端機帳號，資訊部會依照部門主管告知員工之職位  
13 及工作職掌，經過核可，我們才會進行設定存取員工帳號、  
14 密碼對應之權限，終端機伺服器資料夾權限分為個人資料  
15 夾、部門資料夾、跨部門資料夾，若員工點選非權限內之資  
16 料夾，會出現沒有使用資料夾之權限，被拒絕存取之警示，  
17 需要員工透過資訊系統需求申請表提出申請，且經核可，資  
18 訊部才會執行開放權限。以MCS專區來說，因為屬於公司高  
19 度機密，開放權限部分一定會有最高主管李宛霞、黃梅雪簽  
20 核，建置於總經理室資料夾下MCS技轉機密資料，一般員工  
21 無法取得查詢該資料之權限，依當時欣寶公司控管方式，個  
22 別部門人員只能查詢個別部門之MCS相關資料，要做跨部門  
23 查詢，需先填寫資訊系統需求申請表，由該部門主管同意  
24 後，復送交總經理李宛霞或副總經理黃梅雪核准後，再送到  
25 資訊部，資訊部會依據申請內容將該查詢人員加入欲查詢資  
26 料之讀取（包括開啟閱覽、複製）或讀寫（包括開啟閱覽、  
27 複製、修改及刪除）群組內，該申請表就會留在資訊部歸  
28 檔，資訊部會發電子郵件通知申請者及部門主管權限已開  
29 啟，申請者始取得授權而得以閱覽。又欣寶公司並沒有允許  
30 一般員工得私人使用桌上型或筆記型電腦連線至公司終端伺  
31 服器擷取營業秘密資料進行作業或複製儲存於個人電腦內，

01 亦不允許員工將公司內部資料寄給非公務相關人員，或自己  
02 私人電子信箱，或透過網際網路上傳到私人雲端資料夾內，  
03 員工經核准使用外網權限後，公司管控方式分兩類，其一是  
04 網路設定直接過濾不當網站，例如色情、暴力網站，其二會  
05 有1個月內之上網紀錄。另欣寶公司買進終端機伺服器資訊  
06 系統時，即要求廠商直接把這個裝置關閉，所以終端機電腦  
07 無法使用USB等語，並提出欣寶公司當時資料夾儲存讀取權  
08 限表為參（見本院卷二第308頁至第313頁、第316頁至第317  
09 頁、本院卷三第222頁至第223頁、第225頁至第228頁、第23  
10 2頁、第237頁）；復有證人伍世宏於刑案審理時證稱：我在  
11 欣寶公司使用的終端機電腦系統需有個人帳戶、密碼才能使  
12 用工作，且不能使用USB。公用PC可以用USB，不能讀取其他  
13 部門的電子檔案等語；證人王姍懿於刑案審理時證稱：我是  
14 業務部人員，如果需要看其他部門資料，會提出申請，如為  
15 長期跨部門讀取資料，會使用需求表向資訊部申請，以欣寶  
16 公司管理原則，一定要李宛霞總經理或黃梅雪副總經理同意  
17 才能有這樣的權限。又欣寶公司設有文件管制中心，李宛霞  
18 當時是該中心主管，最後核可者是她，文件管制作業程序主  
19 要在規範公司所有ISO文件，即國際標準認證的所有作業流  
20 程都要文件化、制度化辦法，要怎麼管理、回收、開放、哪  
21 些人有權限，我認為這都是屬於權限之控管，對我而言，我  
22 看不到的資料都是屬於機密，因為無法互相分享，我有試過  
23 點選沒有權限之資料夾，但是點不進去，點了會顯示我沒有  
24 權限。基本上各部門依作業流程都要文件化進入文件管制中  
25 心管理，一般員工沒有權限進去文件管制中心閱覽文件，要  
26 透過填寫文件借閱之申請表單。再者，我是負責把三井專利  
27 移轉進來的對口，MCS公司人員在交接會議表示這些MCS專利  
28 轉讓及相關Know-how等都沒有對外公開，此經MCS公司在日  
29 本當地政府機關公證此事，對我們廠內來講，MCS資料就是  
30 機密，所有存放MCS資料夾就是以機密資料方式控管，無法  
31 對外公開，也不得放在公用資料夾分享。另我在欣寶公司是

01 使用終端機電腦系統，不能使用USB，因為業務部必須分析  
02 產業訊息，我有填寫資訊需求表申請對外連結網路，並非全  
03 公司的人都可以使用終端機連到外面網路，需要與業務職掌  
04 相關等語（見本院卷三第74頁至第75頁、第78頁、第657頁  
05 至第658頁、第663頁至第664頁、第666頁至第667頁、第672  
06 頁、第673頁至第676頁），均可見欣寶公司於93年間執行建  
07 置終端機伺服器，由資訊系統建置文件，並管控於電腦設備  
08 使用USB裝置，僅有業務需求少數開放使用，以避免資料經  
09 由USB儲存裝置流出，又對外網路及電子郵件均設有權限管  
10 制，有業務需求者，須填「資訊系統需求申請表」等表單，  
11 經主管核可後始得使用對外網路及電子郵件。

12 ③另審酌被告黃梅雪於刑案調查時陳稱：以我在欣寶公司之層  
13 級，是隨時都可以查詢到新蝕刻技術、MCS技術之相關檔案  
14 或資料，但一般員工因業務需要，如果必須查詢或閱覽上開  
15 檔案或資料，必須做文件申請之動作，詳細申請流程我不清  
16 楚，但公司所有文件都是依照ISO規定來做文件控管等語  
17 （見本院卷二第324頁至第325頁）；被告林建一於刑案偵查  
18 時陳稱：我一開始在欣寶公司擔任乾製程主任，後來升任為  
19 整個製程部之主管。在欣寶公司任職期間，部門員工因業務  
20 需要，必須查詢或閱覽新蝕刻技術、自日本MCS公司受讓及  
21 技術轉移COF G2技術或know-how（即MCS技轉技術）等相關  
22 檔案或資料時，要先填寫紙本之文件申請單，經過申請人所  
23 屬部門主管及總經理或副總經理審核簽名後，才能向文件控  
24 管中心查詢。我自己要查閱，也是要填寫紙本文件申請單，  
25 經由總經理或副總經理審核後放行。欣寶公司是ISO認證公  
26 司，所以只要是業務上相關文件，都由文件控管中心控管等  
27 語（見同卷第329頁至第330頁）；被告夏志雄於刑事偵查中  
28 陳稱：我在原告入主欣寶公司初期期間，員工因業務需要，  
29 必須查詢或閱覽新蝕刻技術相關檔案或資料時，依文件管制  
30 辦法，向文管中心提出申請，申請完後經過相關主管單位間  
31 簽核後，就可以調閱等語（見同卷第336頁）；被告蔡金保



01 於刑案調查時陳稱：我在欣寶公司期間，查詢新蝕刻技術或  
02 MCS技轉技術相關檔案或資料之流程，須先由申請者填寫資  
03 訊系統申請單，由部門主管簽名或蓋章核准後，再經過最高  
04 權責主管李宛霞或黃梅雪授權許可，文件管控中心會視申請  
05 查閱之內容，列印出來後給李宛霞或黃梅雪覆閱再送交申請  
06 者，或是以電子郵件方式傳送至申請者信箱，另公司一般也  
07 不允許申請者跨部門查詢相關檔案或資料，這是基於營業秘  
08 密防止商業間諜或有心人士竊取公司製程技術機密等語（見  
09 同卷第338頁至第339頁），及依被告等人在職時之欣寶公司  
10 員工工作規則、獎懲管理辦法（見本院卷三第297頁至第317  
11 頁），亦見欣寶公司明確規範員工不得對外洩漏各單位業務  
12 或技術上機密及相關懲戒規定。由上可知，技術文件A、C如  
13 附表二編號1-1至1-3、3技術內容欄所示資訊，原告所承受  
14 之欣寶公司於主觀上不僅有當作秘密保護之意，客觀上亦對  
15 得接觸資訊之人加以管制，依業務需要分類、分級並授予不  
16 同職務等級接觸權限，並訂定相關文件管理辦法，應讓員工  
17 能知悉該等資訊屬於公司營業秘密，已使該等資訊以不易被  
18 任意接觸之方式予以控管，而能達到保密之目的，應認上開  
19 資訊已盡「合理保密措施」。

20 ④被告固辯稱：被告李宛霞等人並無與欣寶公司簽署保密契  
21 約，欣寶公司全體員工可透過置於設計部內之公用電腦而任  
22 意接觸、取得、列印上開技術文件；又公司內部人員對於該  
23 等技術文件可任意使用USB存取、任意用電子郵件傳送及上  
24 傳雲端硬碟云云，並以許勝華、王志宏、伍世宏於刑案審理  
25 時109年8月14日審判筆錄為憑（見本院卷三第689頁至748  
26 頁），惟觀諸證人伍世宏、許勝華證述內容，可知證人許勝  
27 華並無開過設計部之stella公用電腦，亦無以usb存取過該  
28 台電腦；證人王志宏雖證稱有使用過設計部門放在門口的公  
29 用電腦，且有將負責之MCS部分資料從個人Terminal丟到會  
30 議室前面電腦，再用USB存取等情，惟此與設計部內之公用  
31 電腦是否存有該技術文件而任由員工接觸、取得、列印等情

01 毫無關聯，且證人王志宏當時為欣寶公司處理負責MCS部分  
02 資料，則其因業務所需而將該資料傳送至公用電腦並取用，  
03 亦與常情無違；又證人伍世宏雖證稱使用公用電腦開機後不  
04 用輸入自己帳號、密碼，當時IP幫我們製作批次檔，只要點  
05 下去就可以使用自己部門的檔案等內容，然其亦稱其所謂批  
06 次檔是在大辦公室及二樓實驗室的公用電腦，其未使用過設  
07 計部的公用電腦，復無法確認批次檔之文件具體內容，則依  
08 前述證人證述內容均無從證明設計部內之公用電腦內存有技  
09 術文件A、C，甚而證明當時欣寶公司內部人員得將該等技術  
10 文件任意使用USB存取、或用電子郵件傳送及上傳雲端硬碟  
11 之事實。再者，證人孫安勇於刑案審理證稱：設計部門之公  
12 用電腦Stella，是部門主管同意後，才能由與職務相關之同  
13 仁使用，當時部門主管是蔡金保，至於蔡金保同意何人使  
14 用，我不會知道等語（見本院卷五第206頁至第207頁），是  
15 設計部門之公用電腦既須經由部門主管同意後使用，可徵欣  
16 寶公司並無任由全體員工透過設計部內之公用電腦接觸、取  
17 得、列印其內資料。至被告蔡金保於刑案審理時雖以證人身  
18 分證稱：在欣寶公司設計部之公用電腦，全廠都可以看到技  
19 術文件A的檔案，我把帳號、密碼貼上電腦上面，要使用不  
20 需要經過我同意，直接把電腦密碼KEY進去就好了，因為那  
21 是我們自己管理的。帳號、密碼是同一個，例如Stella1就  
22 是KEY stellal，密碼也是stellal，Stella2就是KEY stell  
23 a2，密碼也是stella2等語（見本院卷三第529頁、本院卷五  
24 第582頁），但查，技術文件A既為欣寶公司營業秘密，且需  
25 視員工職級而有不同存取權限之方式管制，業如前述，被告  
26 蔡金保證述之帳號、密碼內容顯非屬欣寶公司開放該資訊存  
27 讀取權限之特定員工帳號、密碼，而僅為因業務需求使用開  
28 啟公用電腦之帳號、密碼，則被告蔡金保稱該帳號、密碼得  
29 以存讀取技術文件A之相關檔案等情，已難認可採；參以證  
30 人孫安勇前述證詞，可知被告蔡金保為當時設計部部門主  
31 管，有管理公用電腦之權限，縱其容任技術文件A之相關檔

01 案置於設計部公用電腦內，且任由他人讀取該等資訊，實為  
02 其管理上疏失，亦不得認欣寶公司有同意全體員工可透過置  
03 於設計部內之公用電腦而任意接觸、取得、列印上開技術文  
04 件。況證人孫安勇當時已依任職欣寶公司之總經理即被告李  
05 宛霞指示，建構欣寶公司終端機伺服器之資訊系統以保護公  
06 司資料，並將除公用電腦外之公司資訊系統設置為不得使用  
07 USB存取，復依前述，欣寶公司內部技術文件資料、檔案等  
08 亦透過配發員工個人專屬帳號、密碼，按員工職級設定不同  
09 存取權限之方式而為控管，並有限制存取資料之相關管理方  
10 式，再參酌孫安勇於101年8月6日寄發關於資料夾權限與李  
11 宛霞、黃梅雪之電子郵件（見本院卷五第59頁至第62頁），  
12 足見證人孫安勇確依指示將MCS公司相關技轉檔案設置員工  
13 觀覽存取之權限，則無論欣寶公司當時是否因經費而未完整  
14 執行稽核程序，或建置其他更完整之保密設備或方式，仍不  
15 得認其未盡合理保密措施。另欣寶公司是否與被告李宛霞等  
16 人簽署保密合約，實非判斷其有無採取合理保密措施之唯一  
17 標準，本院綜合審酌前述相關證據，認欣寶公司對於前述技  
18 術文件已採取合理保密措施，故被告此部分所辯，洵非可  
19 採。

20 3. 小結：技術文件A、C如附表二編號1-1至1-3、3技術內容欄  
21 所示資訊，符合營業秘密法第2條所稱「秘密性」、「經濟  
22 價值」、「合理保密措施」之要件，自屬營業秘密法所稱之  
23 營業秘密。

24 (二)技術文件A、B、C、D如附表二各編號技術內容欄所示資訊，  
25 是否與系爭專利甲至己各請求項構成實質相同：

26 1. 系爭專利甲請求項1與技術文件A如附表二編號1-1技術內容  
27 欄所示資訊比對：

28 (1)系爭專利甲請求項1申請專利範圍為：「一種印刷電路板佈  
29 線校正系統，包含：一資料庫，用以儲存數種佈線圖案、各  
30 該佈線圖案的數個規格條件，及各該規格條件之基準值，該  
31 佈線圖案係由數個圖案區塊之間形成的轉折通道，該數個規

01 格條件係包含該轉折通道之一第一通道寬、一第二通道寬及  
02 一節距，該節距係該第二通道寬加上一邊的圖案寬度，該數  
03 個基準值係包含一節距基準值及一通道差異基準值；及一處  
04 理模組，用以測量及修改一印刷電路板之線路圖，該處理模  
05 組耦合連接該資料庫，由該處理模組比較該線路圖，與該資  
06 料庫內的數種佈線圖案及其數個規格條件，當該節距小於該  
07 節距基準值，且該第一通道寬與該第二通道寬之差值大於該  
08 通道差異基準值時，該處理模組以數個改變條件增加一凸塊  
09 於該轉折通道之外側的圖案區塊。」（主要圖式如附圖一之  
10 一）。

11 (2)查技術文件A如附表二編號1-1技術內容欄所載資訊，○○○  
12 ○○○○○○00000000○○000000 000 000 000000 000000 00  
13 ○○○000000○○○○○○○○○○○○○○○○○○0000000000 0000000000○  
14 ○○○00000○○○○00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
15 ○○○○○○ 0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
16 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00000000○○○○○○○○  
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
18 ○○○00000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
20 000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
21 ○○○○○○○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
22 ○○○○○○，故可對應系爭專利甲請求項1「且該第一通道  
23 寬與該第二通道寬之差值大於該通道差異基準值」之技術特  
24 徵。

25 (3)然由整體觀諸上開圖式，可知此技術內容係○○○○○○○○○  
26 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，故無法對應系爭  
27 專利甲請求項1所載「佈線圖案係由數個圖案區塊之間形成的『轉折通道』」  
28 之技術特徵；復依文字部分記載○○○○○  
29 ○○○○○○○0000000000 0000000000○○○○○○○○○○○○○○○○  
30 ○○○○○○○000000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
02 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
03 ○，並非凸塊，亦無法對應系爭專利甲請求項1所載「增加  
04 一凸塊於該轉折通道之外側的圖案區塊」之技術特徵。

05 (4)故而，技術文件A如附表二編號1-1技術內容欄所載資訊，其  
06 佈線圖案與補償方式既與系爭專利甲請求項1前述申請專利  
07 範圍不同，自無法達成與系爭專利甲請求項1相同之功效或  
08 目的，可見該部分資訊與系爭專利甲請求項1之技術特徵間  
09 存有明顯差異，二者未構成實質相同，實難據此認定系爭專  
10 利甲請求項1之發明構思，係依技術文件A如附表二編號1-1  
11 技術內容欄所載資訊衍生而得。

12 2.系爭專利甲請求項13與技術文件A如附表二編號1-2技術內容  
13 欄所示資訊比對：

14 (1)系爭專利甲請求項13申請專利範圍為：「一種印刷電路板佈  
15 線校正系統，包含：一資料庫，用以儲存數種佈線圖案、各  
16 該佈線圖案的規格條件，及該規格條件之基準值，該佈線圖  
17 案係由導電圖案中挖空形成數個封閉的非導電區域，該規格  
18 條件係一鄰接線寬，該鄰接線寬係二相鄰的封閉區域之間的  
19 導線寬度，該基準值係一線寬基準值；及一處理模組，用以  
20 測量及修改一印刷電路板之線路圖，該處理模組耦合連接該  
21 資料庫，由該處理模組比較該線路圖，與該資料庫內的數種  
22 佈線圖案及其規格條件，當該鄰接線寬小於或等於該線寬基  
23 準值時，該修改單元以數個改變條件分別於各該封閉區域之  
24 末端增加一U型補強。」（主要圖式如附圖一之二）。

25 (2)技術文件A如附表二編號1-2技術內容欄所示資訊，○○○○  
26 ○○○○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
27 0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
28 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
29 ○○○○○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
30 0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
02 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
03 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
04 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○可對應系爭專  
05 利甲請求項1所載「以數個改變條件分別於各該封閉區域之  
06 末端增加一U型補強」之技術特徵。再者，上開資訊內容雖  
07 未揭示「一資料庫，用以儲存數種佈線圖案、各該佈線圖案  
08 的數個規格條件，及各該規格條件之基準值」、「以一處理  
09 模組耦合連接該資料庫，用以測量及修改一印刷電路板之線  
10 路圖」等技術內容，惟此部分資料庫與處理模組僅為進行線  
11 路校正之普通工具，在執行線路校正仍需依照前述資訊所揭  
12 露之U型補償，始能避免線路圖案過度侵蝕而產生凹陷，及  
13 避免線路通道過窄且長，是系爭專利甲請求項13申請專利範  
14 圍，與技術文件A如附表二編號1-2技術內容欄所界定之線路  
15 補償規則，並無實質差異，二者應屬實質相同之創作。

16 (3)被告雖抗辯：技術文件A如附表二編號1-2技術內容欄所示資  
17 訊，與系爭專利甲請求項13針對被線路圍繞而封閉之數個  
18 「封閉的非導電區域」二端進行U型補強不同。又系爭專利  
19 甲請求項13所載之技術內容，已為被告所有修改日期為西元  
20 2011年9月17日「TW0643E-A01」設計圖電子檔所揭露云云。  
21 查依前述，系爭專利甲請求項13申請專利範圍僅界定「封閉  
22 的非導電區域」、「該修改單元以數個改變條件分別於各該  
23 封閉區域之末端增加一U型補強」，可知其未限定非導電區  
24 域之一端或兩端封閉，亦未界定佈線圖案之形狀，而由技術  
25 文件A如附表二編號1-2技術內容欄所示資訊，其文字所載  
26 「U型內角處需導圓角」，已教示至少一端封閉處需導圓  
27 角，縱為兩端皆封閉之封閉區域，亦屬於上開資訊提出之貢  
28 獻所及，且對照其圖式，該資訊復揭示外圍需多凸之部分及  
29 形狀（即為U型），則二者並無被告所辯稱不同之情形。再  
30 觀諸前開設計圖電子檔之電腦網頁截圖（見限閱卷三第201  
31 頁至第215頁），其內容並無揭示前述線寬基準值及線寬在

01 何種條件下須進行補償之技術資訊，本院自難僅憑該設計圖  
02 電子檔之相關圖式而為被告有利之認定。此外，被告復無提  
03 出其他證據資料以證明其所辯為真，是此部分抗辯，實非可  
04 採。

05 3.系爭專利乙請求項1與技術文件A如附表二編號1-3技術內容  
06 欄所示資訊比對：

07 (1)系爭專利乙請求項1申請專利範圍為：「一種端部外擴的光  
08 罩，包含：一基板，具有相互正交的一X方向與一Y方向，該  
09 基板係由透光材質所製成；數個遮蔽件，該數個遮蔽件位於  
10 該基板並以X方向並排並沿Y方向延伸，各該遮蔽件具有至少  
11 一端部；及數個外擴部，各該外擴部連接於各該遮蔽件的至  
12 少一端部。」（主要圖式如附圖二）。

13 (2)技術文件A如附表二編號1-3技術內容欄所示資訊，○○○○  
14 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
15 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0  
16 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0  
18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0  
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
20 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0  
21 ○○○○，可對應系爭專利乙請求項1所載「數個外擴部，  
22 各該外擴部連接於各該遮蔽件的至少一端部」之技術特徵，  
23 是系爭專利乙請求項1申請專利範圍所示之頭部補償，與上  
24 開資訊所揭示之端部外擴光罩，並無實質差異，二者應屬實  
25 質相同之創作。

26 (3)被告雖抗辯：技術文件A如附表二編號1-3技術內容欄所示資  
27 訊，○○○○0○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
28 項1僅在遮蔽件端部形成外擴部分，二者之技術內容有實質  
29 差異。又系爭專利乙請求項1所載之技術內容，已為被告所  
30 有修改日期為西元2011年9月17日「TW0643E-A01」設計圖電  
31 子檔所揭露。另系爭專利乙係針對以「半加成法」製造軟性

01 電路板之過程中所發生的問題進行改良，與利用習知蝕刻法  
02 製造之電路板不同云云。然查，技術文件000000 0000○  
03 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00000 0000○○○○○  
04 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
05 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0000  
06 0○○○○○○○○○○○○000○000○○○○○○○○○○0○○○○○  
07 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
09 ○○○○○○，而被告所稱整體外擴實係原線路設計圖樣，  
10 其位置在光罩遮蔽件之內部，並非光罩遮蔽件之端部，技術  
11 文件A○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
12 ○○○○○○○○○○○，與系爭專利乙界定之外擴部相同。又  
13 查，被告所指之橘框放大處（見限閱卷三第213頁）僅具  
14 長、短線路，而長線路之端部並無連接外擴部，而短線路之  
15 線路為內凹設計亦無外擴部，遍觀前開設計圖電子檔之電腦  
16 網頁截圖（見限閱卷三第201頁至第215頁），亦無系爭專利  
17 乙請求項1關於遮蔽件端部形成外擴部分之內容，本院自難  
18 僅憑該設計圖電子檔之相關圖式而為被告有利之認定。再  
19 者，系爭專利乙請求項1僅界定光罩之結構，並未限定使用  
20 半加成法，且係藉由外擴部將遮蔽件端部擴大，其目的在於  
21 增加顯影後線路端部面積，確保線路端部完整性，而與技術  
22 文件A如附表二編號1-3技術內容欄所示資訊，其目的在於避  
23 免線路端部過度侵蝕產生缺陷，影響線路完整性，二者實屬  
24 相同，況縱系爭專利乙請求項1所載光罩設計應用於蝕刻  
25 法，亦可達成相同功效。綜此，被告此部分所辯，均不足  
26 採。

27 4.系爭專利丙請求項1與技術文件A如附表二編號1-4技術內容  
28 欄所示資訊比對：

29 (1)系爭專利丙請求項1申請專利範圍為：「一種軟性電路板，  
30 包含：一軟性基材，具有相對的一第一表面及一第二表面；  
31 一電路層，附著於該軟性基材之第一表面；及至少一空白



01 部，相鄰於該電路層，該至少一空白部具有一標示部及一墊  
02 高層，該墊高層鄰近該標示部，該墊高層係具有一直條部及  
03 一加強部，該加強部連接該直條部，且該標示部的表面不凸  
04 出該墊高層的表面。」（主要圖式如附圖三）。

05 (2)技術文件A如附表二編號1-4技術內容欄所示資訊，係揭示○  
06 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
07 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

11 (3)系爭專利丙說明書第【0003】段所載「一般軟性電路板是在  
12 基層上蝕刻出銅電路，請參照第1圖，其係一種習知的軟性  
13 電路板9，該習知的軟性電路板9具有一軟性基材9a，其生產  
14 流程主要包括：曝光→顯影→電路蝕刻或電路電鍍→去除不  
15 需要的銅箔→表面處理等過程，使該軟性基材9a上可以形成  
16 一印刷電路區91及一外接線路區92，該軟性基材9a於該外接  
17 線路區92的兩側則分別具有未經過上述處理過程的一留白區  
18 93，各該留白區93具有一標示部931，各該標示部931用以供  
19 後續封裝製程或裁切時對位使用」內容（見本院卷一第125  
20 頁至第126頁），可知系爭專利丙之「空白區」係位於軟性  
21 電路版外接線路區之兩側，未經製程處理之留白區；而說明  
22 書第【0004】段所載「根據軟性電路板9的可撓性之性質，  
23 上述習知軟性電路板9的生產製程中，係將數個相連接的軟  
24 性電路板9彎捲，以便能以捲對捲作業的方式輸送。然而，  
25 由於該標示部931係附著於該留白區93，使得該標示部931的  
26 表面凸出於其他留白區93的表面，且位於該標示部931周邊  
27 的留白區93比較柔軟；因此，在捲入或捲出的過程中，此處  
28 容易下陷產生刮傷，因而常導致該標示部931刮傷及損壞，  
29 造成外觀缺陷導致影響軟性電路板的良率，嚴重者更會造成  
30 報廢率的增加，進而影響產品品質」內容（見本院卷一第12  
31 6頁），亦可知該標示部位於留白區中，且標示部表面凸出

01 於留白區之表面，在軟性電路板捲入或捲出的過程中，常導  
02 致標示部刮傷及損壞影響良率之問題。

03 (4)經比對上述技術內容，技術文件A如附表二編號1-4技術內容  
04 欄所示資訊，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
05 ○○與系爭專利丙所稱位於軟性電路版外接線路區之兩側且  
06 未經製程處理之空白區，二者並不相同。原告雖稱：○○○  
07 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
11 於系爭專利丙請求項1所稱之標示部，且無法達成與系爭專  
12 利丙請求項1相同之功效或目的，本院自無從以原告前述主  
13 張而為其有利之認定。基此，技術文件A如附表二編號1-4技  
14 術內容欄所示資訊與系爭專利丙請求項1之技術特徵間存有  
15 明顯差異，二者未構成實質相同，即難據此認定系爭專利丙  
16 請求項1之發明構思，係依技術文件A如附表二編號1-4技術  
17 內容欄所載資訊衍生而得。

18 5.系爭專利丁請求項1、7與技術文件B如附表二編號2技術內容  
19 欄所示資訊比對：

20 (1)系爭專利丁請求項1、7申請專利範圍分別為：「一種具有總  
21 跨距輔助測量記號之軟性電路板，包含：一基板，具有相正  
22 交的一X方向與一Y方向；一線路層，該線路層位於該基板，  
23 該線路層具有呈斜向設置的數個電路條，其中二前述的電路  
24 條的中心線上分別具有一指定處；及二記號，與該線路層一  
25 併成型於該基板，該二記號的中心線或邊線分別與該二指定  
26 處向Y方向延伸的一指定線重合，或該二記號的中心點分別  
27 通過該指定線。」、「一種具有總跨距輔助測量記號之軟性  
28 電路板，包含：一基板，具有相正交的一X方向與一Y方向；  
29 一線路層，該線路層位於該基板，該線路層具有呈斜向設置  
30 的數個電路條，其中二前述的電路條的中心線上分別具有一  
31 指定處；及二記號，與該線路層一併成型於該基板，該二記

01 號的中心線或邊線分別與該二指定處向X方向延伸的線重  
02 合，或該二記號的中心點分別通過該二指定處向X方向延伸  
03 的線。」（主要圖式如附圖四）。

04 (2)技術文件B如附表二編號2技術內容欄所示資訊，雖揭示○○  
05 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
06 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
07 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
10 ○○是上開資訊與系爭專利丁請求項1、7申請專利範圍所載  
11 之技術特徵間存有明顯差異，自難據以認定系爭專利丁請求  
12 項1、7之發明構思，係依技術文件B如附表二編號2技術內容  
13 欄所載資訊衍生而得。

14 (3)原告所稱：系爭專利丁請求項1、7申請專利範圍並未界定或  
15 限縮「記號」與「電路條上指定處」具體用途與所在位置，  
16 而技術文件B如附表二編號2技術內容欄所示資訊○○○○○  
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
20 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
21 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
22 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○云云。惟依系  
23 爭專利丁請求項1所載「一種具有總跨距輔助測量記號之軟  
24 性電路板」，可知其所指之記號係用於輔助測量總跨距，復  
25 參以系爭專利丁說明書第【0003】段所載「以現今業界上的  
26 習慣，客戶會在高佈線率之習知的一軟性電路板設計圖9  
27 上，針對線路高度密集處指定任意二線路91。並在該二線路  
28 91上指定二指定點，以界定該二線路91在X方向上具有一總  
29 跨距……」等語（見本院卷一第141頁），益徵系爭專利丁  
30 請求項1所揭示之記號或指定處，係用以量測線路高度密集  
31 處之總跨距。經比對技術文件B如附表二編號2技術內容欄所  
示資訊，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○則依技術文件B如附表二編號2技術  
內容欄所示資訊，該所屬技術領域之人並無從以該資訊之對  
位孔中心線或邊緣與指定處向Y方向延伸的一指定線重合，  
是上開資訊所顯示之對位孔，顯與系爭專利丁請求項1、7所  
載之記號不同。況上開資訊所揭示SR對位標記之設置規則，  
皆與在斜向電路之中心線上找一指定處無關，遑論對位孔的  
中心線或邊緣與二指定處向X方向（或Y方向）延伸的線重  
合。另參酌技術文件B亦記載○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○等語（見限閱卷一第66頁），更可  
見上開資訊所顯示之對位標記，與系爭專利丁請求項1、7所  
揭示輔助測量總跨距之記號並無關聯。基上，原告此部分主  
張，尚非可採。

6.系爭專利戊請求項1與技術文件C如附表二編號3技術內容欄  
所示資訊比對：

(1)系爭專利戊請求項1申請專利範圍為：「一種印刷電路板交  
錯線路改善系統，包含：一資料庫，用以儲存數種佈線圖  
案、各該佈線圖案的數個規格條件，及各該規格條件之基準  
值，該佈線圖案係由數個長線路圖案及數個短線路圖案交錯  
排列，該數個規格條件係包含各該線路圖案之一線寬及一節  
距；及一處理模組，用以測量及修改一印刷電路板之線路  
圖，該處理模組耦合連接該資料庫，由該處理模組比較該線  
路圖，與該資料庫內的數種佈線圖案及其數個規格條件，再  
由該處理模組修改各該長線路圖案。」（主要圖式如附圖  
五）。

(2)技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊，○○○○○○  
○○○○○○0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00000000○○  
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0000○○0000○○0

01 000○ ○0000○●○●○0000○●○●○●○●○●○●○●○0000○●○●  
02 ○00000 0000○●○●○0○●○000○●○●○●○●○●○0○●○●○●○●○  
03 ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○0000○●○●○●○●○●○●○●○0000  
04 000○●○000000○●○●○●○●○●○●○●○●○●○0000○●○●○●○  
05 000○●○0000○●○●○●○●○0000○●○●○●○●○●○●○●○●○ 00  
06 0000○●○●○●○●○●○●○●○●○●○即可對應於系爭專利戊請求項  
07 1所載「該數個規格條件係包含各該線路圖案之一節距」、  
08 「修改各該長線路圖案」等技術特徵。再者，○●○●○●○  
09 ○0000○●○●○●○0000○●○●○00000○●○●○●○●○●○●○  
10 ○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○0000○●○●○●○●○●○00  
11 00○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○  
12 ○0 ○●○●○●○●○●○●○0000○●○●○●○●○●○●○0○0 ○●  
13 ○●○●○●○，故得對應於系爭專利戊請求項1所載「該數個  
14 規格條件係包含各該線路圖案之一線寬」、「修改各該長線  
15 路圖案」等技術特徵。

16 (3)依前所述，技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊，  
17 僅未揭示一資料庫，用以儲存數種佈線圖案、各該佈線圖案  
18 的數個規格條件，及各該規格條件之基準值；及以一處理模  
19 組耦合連接該資料庫，用以測量及修改一印刷電路板之線路  
20 圖等技術內容，惟系爭專利戊請求項1所指之資料庫與處理  
21 模組係為進行線路校正之普通工具，在執行線路校正仍需依  
22 照前開資訊所揭示長短線路交錯排列之補償值及線路末端之  
23 尖頭部，始能避免大小線寬交界、線路末端產生不規則蝕刻  
24 痕，是系爭專利戊請求項1申請專利範圍與技術文件C如附表  
25 二編號3技術內容欄所示資訊，二者所揭示之線路補償規則  
26 並無實質差異，應屬實質相同之創作。

27 (4)被告抗辯：技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊  
28 ，前後各自獨立，不具關聯無從混用，且該資訊無法用於引  
29 腳根部之補償，亦與系爭專利戊請求項1所揭示直接在線路  
30 外側以增寬幅度將線路加寬不同，又未揭示「線寬基準  
31 值」、「節距基準值」，亦未說明是否需同時滿足或只要滿

01 足任一即實施補償，與系爭專利戊請求項1之技術特徵不  
02 同，另系爭專利戊請求項1所揭示技術特徵均係由被告所有  
03 已存在「修改交錯佈線圖案」、「延伸尖頭」之技術衍生而  
04 來云云，並提出修改日期西元2011年9月17日「TW0643E-A0  
05 1」設計圖電子檔、修改日期西元2011年9月30日「N00037E-  
06 A01」設計圖電子檔等相關電腦截圖、光碟等為證（見限閱  
07 卷三第201頁至第215頁、第231頁至第243頁、證物袋）。惟  
08 查，技術文件C為原欣寶公司設計部門人員據此製作光罩之  
09 設計準則，上開資訊內容則均屬於繪製光罩圖進行補償時須  
10 適用之規則，實際作業當綜合全部規則整體使用。又查，系  
11 爭專利戊請求項1僅界定「該佈線圖案係由數個長線路圖案  
12 及數個短線路圖案交錯排列」、「修改各該長線路圖案」、  
13 「由該處理模組比較該線路圖，與該資料庫內的數種佈線圖  
14 案及其數個規格條件，再由該處理模組修改各該長線路圖  
15 案」等技術特徵，而不限於對長引腳之根部須修改，亦不限  
16 於「不具有延伸斜線段」，且未限定數個規格條件是否皆符  
17 合才進行修改，而與被告所辯前情均有未符。另觀諸前揭修  
18 改日期西元2011年9月17日「TW0643E-A01」設計圖電子檔、  
19 修改日期西元2011年9月30日「N00037E-A01」設計圖電子檔  
20 及相關電腦截圖，均未揭示線寬、節距在何種條件下須進行  
21 補償之技術內容，被告亦無舉證證明其如何由上開證據資料  
22 衍生創作出系爭專利戊請求項1所載申請專利範圍之過程及  
23 方式，本院自難僅憑上開證據而為被告有利之認定。綜上，  
24 被告前開抗辯內容，均不足採。

25 7.系爭專利己請求項1與技術文件D如附表二編號4技術內容欄  
26 所示資訊比對：

27 (1)系爭專利己請求項1申請專利範圍為：「一種印刷電路板線  
28 路強化系統，包含：一資料庫，用以儲存數種線路圖案、各  
29 該線路圖案的數個規格條件，及各該規格條件之基準值，該  
30 數個規格條件係包含各該線路圖案之一第一線寬及一第二線  
31 寬，該第一線寬係小於該第二線寬；及一處理模組，用以測



01 一所為申請系爭專利乙（請求項1）、丁（請求項1、7）、  
02 戊（請求項1）之行為；被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪、蔡  
03 金保、林建一所為申請系爭專利丙之行為，分別侵害原告就  
04 技術文件A、B、C、D如附表二各編號技術內容欄所示之營業  
05 秘密，應連帶負擔損害賠償責任等情，然為被告所否認，並  
06 以前詞置辯，經查：

07 1.技術文件A、B、D如附表二編號1-4、2、4技術內容欄所示資  
08 訊，不具秘密性，而非屬營業秘密法所保護之客體；又技術  
09 文件A如附表二編號1-1技術內容所示資訊，雖屬原告營業秘  
10 密，然依原告所提出之證據資料並無法證明系爭專利甲請求  
11 項1與技術文件A如附表二編號1-1所示資訊為實質相同之創  
12 作，均經本院認定如前，足見技術文件A、B、D如附表二編  
13 號1-4、2、4技術內容欄所示資訊，非屬營業秘密，且系爭  
14 專利甲請求項1，亦難認與技術文件A如附表二編號1-1所示  
15 資訊有何關聯。基此，原告指稱上揭被告申請系爭專利甲  
16 （請求項1）、系爭專利丙（請求項1）、系爭專利丁（請求  
17 項1、7）、系爭專利己（請求項1），侵害其就技術文件A、  
18 B、D如附表二編號1-1、1-4、2、4技術內容欄所示營業秘密  
19 等情，均屬無據。

20 2.被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保所為申請系爭專利甲（請求項  
21 13），共同侵害原告所有技術文件A如附表二編號1-2技術內  
22 容欄所示之營業秘密；被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保所為申  
23 請系爭專利乙（請求項1），共同侵害原告所有技術文件A如  
24 附表二編號1-3技術內容欄所示之營業秘密：

25 (1)查技術文件A原係由被告蔡金保任職於原告時所製作，嗣被  
26 告蔡金保改任職於被告易華公司後，經檢警所扣得其所使用  
27 之隨身硬碟內，查內有檔案名稱為「HXQTESTJMC-UNE (Low  
28 pressure-DEV-1-MEC).xls」之技術文件等情，為兩造所不  
29 爭執，並有前開檔案內容在卷可查（見本院卷四第494頁、  
30 本院卷五第415頁、限閱卷二第169頁至第174頁），經比對  
31 技術文件A、檔案名稱「HXQTESTJMC-UNE (Low pressure-DE



01 V-1-MEC) .xls」技術文件內容（見限閱卷一第7頁至第12  
02 頁、限閱卷二第169頁至第174頁），可見兩者整體文件內容  
03 之編排、架構、圖形、文字敘述等幾近完全相同，雖就部分  
04 參數有所變更，然就核心技術觀念、方法、重點內容均屬一  
05 致，足徵被告蔡金保使用於被告易華公司隨身硬碟內之檔案  
06 名稱「HXQTESTJMC-UNE (Low pressure-DEV-1-MEC) .xls」  
07 之技術文件，應為重製於技術文件A而來。又被告蔡金保任  
08 職原告時，擔任設計工程部經理，並依其職務為原告所製作  
09 技術文件A，當知技術文件A如附表二編號1-2、1-3技術內容  
10 欄所示之資訊係屬原告就COF製程技術之營業秘密，然仍擅  
11 自將包含如附表二編號1-2、1-3技術內容欄所示之資訊之技  
12 術文件A全部電子檔案重製，並使用於被告易華公司，且據  
13 此申請與上開技術實質相同之系爭專利甲請求項13之申請專  
14 利範圍內容、系爭專利乙請求項1之申請專利範圍內容，則  
15 其基於與原告間僱傭關係而製作取得之技術文件A，於離職  
16 後再予使用於被告易華公司之行為，即屬營業秘密法第10條  
17 第1項第4款規定侵害營業秘密之情形。至原告雖主張被告蔡  
18 金保另構成營業秘密法第10條第1項第2款侵害營業秘密行為  
19 乙節，然依營業秘密法第10條規定之立法理由稱：「該條第  
20 1項第4款係規範基於類如僱傭、委任等雙方法律行為或單方  
21 法律行為如代理權之授與之營業秘密侵害情形。本款之特徵  
22 在於受雇人、受任人、代理人或交易相對人取得雇用人、委  
23 任人、本人或他方之營業秘密，往往係因該等關係而『正當  
24 取得』，亦即其營業秘密並非以不正當方法取得，此與前三  
25 款之規定均有所不同。」等語，可知該條項第2款、第4款所  
26 規定取得營業秘密之方式並不相同，且無法併存，被告蔡金  
27 保既係因與原告間僱傭關係而正當取得技術文件A，即未符  
28 營業秘密法第10條第1項第2款侵害營業秘密行為之構成要  
29 件，原告此部分主張，應非有據。

30 (2)被告雖辯稱：檔案名稱為「HXQTESTJMC-UNE (Low pressure  
31 -DEV-1-MEC) .xls」之技術文件係訴外人黃信揚於易華公司

01 留職停薪前後，由其主管即被告蔡金保將其個人電腦內檔案  
02 備份至隨身硬碟時所夾帶之資訊，被告蔡金保並未注意且未  
03 開啟過，其公務電腦內並未有上開檔案云云，並提出被告蔡  
04 金保於刑案審理時以證人身分所為證述內容、上開檔案資訊  
05 截圖為證（見限閱卷三第526頁至第529頁、第547頁），觀  
06 諸該檔案資訊截圖內容，雖有記載建立日期為1998/9/29上  
07 午11：16，上次修改日期為2014/9/4下午01：44，上次修改  
08 者為「HY. Huang」，惟據此仍無從證明上開檔案資訊之修改  
09 者「HY. Huang」為黃信揚、被告蔡金保存取該檔案時間、被  
10 告蔡金保於檢警扣案隨身硬碟前並未曾檢視上開檔案內容等  
11 事實，至被告蔡金保所有公務電腦內是否另存有上開檔案，  
12 核與其構成上開侵害營業秘密行為無必然關聯，本院實無從  
13 僅憑被告蔡金保於刑案中所為證述內容及上開檔案資訊截圖  
14 而為其有利之認定。此外，被告並無提出其他積極證據以證  
15 明其所辯前情屬實，是其此部分所辯，尚難採信。

16 (3)所謂共同侵權行為，係指數人共同不法對於同一之損害，與  
17 以條件或原因之行為。加害人於共同侵害權利之目的範圍  
18 內，各自分擔實行行為之一部，互相利用他人之行為，以達  
19 其目的者，仍不失為共同侵權行為人，自應對於全部所發生  
20 之結果，連帶負損害賠償責任。是民法第185條共同侵權行  
21 為之成立，與刑法上之共同正犯不同，共同侵權人之間並無  
22 須犯意聯絡，亦無須參與全部侵害行為，僅需行為有共同關  
23 連，即應成立共同侵權行為。查被告李宛霞、黃梅雪原於欣  
24 寶公司任職時分別擔任總經理、副總經理，依其當時業務範  
25 圍均已知悉技術文件A包含如附表二編號1-2、1-3技術內容  
26 欄所示資訊之全部內容，且經被告李宛霞、黃梅雪於本院審  
27 理時承認其等於欣寶公司時均有權限得以隨時點選進入、存  
28 取技術文件A之事實等情（見本院卷四第492頁至第493  
29 頁），又被告李宛霞、黃梅雪於103年7月1日受聘於被告易  
30 華公司，即擔任被告易華公司之總經理、副總經理，並負責  
31 與原公司相同之職務內容，復參以其等均為該領域之專業人

01 士，且為被告蔡金保等人之上級主管，應認被告蔡金保以系  
02 爭專利甲、乙為發明人為申請專利時，其等即應知悉系爭專  
03 利甲請求項13、系爭專利乙請求項1之技術內容，各與原欣  
04 寶公司所有技術文件A如附表二編號1-2、1-3技術內容欄所  
05 示資訊，屬於實質相同之創作，是其等主觀上已知申請系爭  
06 專利甲、乙之行為，將造成原告就技術文件A如附表二編號1  
07 -2、1-3技術內容欄所示資訊遭公開而喪失秘密性，仍為該  
08 等專利申請之批核，核屬故意，且其等所為與被告蔡金保前  
09 述侵害原告營業秘密之行為，均為原告受有損害之共同原  
10 因，自應成立共同侵權行為。至被告雖辯稱被告蔡金保申請  
11 系爭專利甲、乙，並不需經由被告李宛霞、黃梅雪同意或批  
12 核云云，然申請專利需花費相當之金額，且專利權取得後日  
13 後之維護、管理亦需要一定之人力與費用，依被告蔡金保於  
14 易華公司之職務，實難認其得以獨自決定是否申請該等專  
15 利，又被告李宛霞、黃梅雪既為被告蔡金保之上級主管，且  
16 擔任公司總經理、副總經理職務之管理階層，當無可能對於  
17 公司申請專利乙事毫不知情，並全權授權被告蔡金保處理，  
18 被告此部分所辯實與常情相違，且未曾提出任何證據以證明  
19 上開辯解為實，難認有據。

20 (4)從而，原告所有技術文件A如附表二編號1-2、1-3技術內容  
21 所示之資訊為其營業秘密，則被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保  
22 未經原告同意或授權，將原告前開營業秘密以申請系爭專利  
23 甲、乙之方式公開於眾，自屬侵害原告就技術文件A如附表  
24 二編號1-2、1-3技術內容欄所示之營業秘密。

25 3.被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一所為申請系  
26 爭專利戊（請求項1），共同侵害原告所有技術文件C如附表  
27 二編號3技術內容欄所示之營業秘密：

28 (1)查技術文件C原為欣寶公司向MCS公司所購置，且置於欣寶公  
29 司所管制之專用資料夾內，嗣由原告合併欣寶公司而取得其  
30 相關權利，業經本院認定如前，又被告黃梅雪於易華公司辦  
31 公室遭查扣之硬碟中儲存有技術文件C，為兩造所不爭執，

01 有臺灣高雄地方檢察署檢察官105年度偵字第22514號、107  
02 年度偵字第8921號起訴書、刑案扣案硬碟之光碟在卷可查  
03 （見本院卷一第51頁至第77頁、本院卷五第47頁、第49  
04 頁），且經本院於111年5月11日勘驗上開光碟後，結果為  
05 「①開啟光碟後，內容分為『偵查中未協請告訴人辨識之檔  
06 案的匯出檔』、『偵查中有協請告訴人辨識之檔案的匯出  
07 檔』檔案資料夾，螢幕截圖如照片1。②點選進入『偵查中  
08 有協請告訴人辨識之檔案的匯出檔』檔案資料夾後，出現9  
09 筆扣押物品編號之檔案資料夾，螢幕截圖如照片2。③點選  
10 進入『105161-44-32黃梅雪 扣押物編號3-1-7』檔案資料夾  
11 後，內容分為『常見文書』、『電子郵件』、『圖檔或照  
12 片』、『關鍵字』檔案資料夾，螢幕截圖如照片3。④點選  
13 進入『常見文書』檔案資料夾後，內容分為『105161-44-32  
14 -常見文書2.html』、『105161-44-32-常見文書3.html』、  
15 『105161-44-32-常見文書.html』檔案資料夾，螢幕截圖如  
16 照片4。⑤開啟『105161-44-32-常見文書3.html』，內容即  
17 螢幕截圖如照片5。分別於該檔案資料夾下搜尋『SIMPAL2 3  
18 0801SG-EX Alignment』，內容即螢幕截圖如照片6；於該檔  
19 案資料夾下搜尋『NewEtching-G2Photo Mask翻譯』，內容  
20 即螢幕截圖如照片7；於該檔案資料夾下搜尋「製品設計基  
21 準(惠)」，內容即螢幕截圖如照片8。⑥回到『偵查中有協  
22 請告訴人辨識之檔案的匯出檔』資檔案資料夾項下之上述9  
23 筆扣押物品編號之檔案資料夾後，再點選進入『105161-44-  
24 32黃梅雪扣押物編號3-1-5』檔案資料夾，內容分為『常見  
25 文書』、『電子郵件』、『圖檔或照片』、『關鍵字』檔案  
26 資料夾，螢幕截圖如照片9。⑦點選進入『常見文書』檔案  
27 資料夾後，內容為『000000-00-00-常見文書.html』檔案資  
28 料夾，螢幕截圖如照片10。⑧開啟『000000-00-00-常見文  
29 書.html』，內容即螢幕截圖如照片11。分別於該檔案資料  
30 夾下搜尋『SIMPAL23 0801SG-EX Alignment』，內容即螢幕  
31 截圖如照片12；於該檔案資料夾下搜尋『NewEtching-G2Pho

01 to Mask翻譯』，內容即螢幕截圖如照片13；於該檔案資料  
02 夾下搜尋『製品設計基準(惠)』，內容即螢幕截圖如照片1  
03 4。」有本院勘驗筆錄及截圖照片等件附卷為證（見本院卷  
04 五第413頁至第422頁），可徵被告黃梅雪於被告易華公司辦  
05 公室遭查扣之硬碟中存有檔案名稱「NewEtching-G2Photo M  
06 ask翻譯」，確為重製欣寶公司技術文件C而來。

07 (2)被告復辯稱：被告黃梅雪未曾開啟過扣案隨身硬碟內之技術  
08 文件C，自無可能用以申請系爭專利云云，並提出技術文  
09 件C鑑識時間光碟資訊、鑑定證人黃逸華於刑事案件之證述  
10 內容（見限閱卷三第549頁至第553頁），然觀諸鑑定證人黃  
11 逸華所為證述內容，係經被告擷取片段而提出，且核其所為  
12 係對訴外人楊孝武之扣案物內檔案鑑識結果之證述，而非針  
13 對被告黃梅雪前開扣案之隨身硬碟，則該證詞是否得證明被  
14 告黃梅雪未曾開啟過扣案隨身硬碟內之技術文件C，已屬有  
15 疑。又縱得證明此情，然被告黃梅雪既將於欣寶公司儲存之  
16 相關文件、圖檔、郵件等幾近全部重製於扣案隨身硬碟中，  
17 已符合前述侵害營業秘密之行為，亦無法排除重製當時有其  
18 他備份資料，或變更技術文件C檔案名稱等情之可能，實難  
19 僅憑被告黃梅雪未開啟扣案隨身硬碟，而認其於易華公司全  
20 然未使用技術文件C之事實。況被告黃梅雪倘如確未曾開啟  
21 過扣案隨身硬碟內之技術文件C，何以自108年12月13日起訴  
22 時起均未抗辯此情，直於111年10月3日始具狀為此部分抗  
23 辯？是被告所辯上情，與常情相違，難認有理。

24 (3)又查，被告李宛霞原於欣寶公司任職時擔任總經理，依其當  
25 時業務範圍均已知悉技術文件C包含如附表二編號3技術內容  
26 欄所示資訊之內容，且經被告於本院審理時承認其於欣寶公  
27 司時均有權限得以隨時點選進入、存取技術文件C之事實等  
28 情（見本院卷四第492頁至第493頁）。而被告林建一、夏志  
29 雄、蔡金保則於刑案偵查中分別陳稱：「約101、102年間，  
30 欣寶公司要向MCS公司購買整套COF G2蝕刻法的生產線及標  
31 準生產流程，當時副總經理黃梅雪指派我至日本看需要檢測

01 儀器設備，要的儀器就留給我們，不要的儀器就要報廢，另  
02 外我還帶回我認為需要的儀器的操作紙本文件回公司，交給  
03 文件控管中心」、「我在原告入主欣寶公司初期期間，員工  
04 因業務需要，必須查詢或閱覽新蝕刻技術相關檔案或資料  
05 時，依文件管制辦法，向文管中心提出申請，申請完後經過  
06 相關主管單位間簽核後，就可以調閱」、「我在欣寶公司期  
07 間，因為只負責圖面的設計和審核，製程的機台和配方我都  
08 沒有經手，所以我不會申請查詢新蝕刻技術相關檔案或資  
09 料，至於查詢流程是必須先經過公司的文件管制中心審核  
10 後，經製程主管林建一或夏志雄核准，再經最高權責主管可  
11 能是總經理或副總同意後，文管承辦人會把相關調閱資料傳  
12 送給申請者並在文件上簽章，申請者才能查詢或閱覽相關檔  
13 案或資料。又MCS技轉技術相關檔案或資料，查詢申請流程  
14 如同前所述。」等語（見本院卷二第333頁、第336頁、第33  
15 8頁），且依前述，被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志  
16 雄、林建一均為至日本接受MCS公司相關技術轉移受訓之員  
17 工，其等自得接觸該等技術文件，且應知悉該等技術文件為  
18 欣寶公司之營業秘密。況技術文件C當時存放於欣寶公司電  
19 腦伺服器之「5-3-設計技術Gr（CAD設計相關）-保哥」檔案  
20 資料夾，被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保均有對該資料之存取  
21 權限，此有檢視存取權限過程之公證書及所檢附圖89、93、  
22 97內容在卷可參（見本院卷五第437頁至第447頁、第537  
23 頁、第541頁、第545頁）。另參以被告李宛霞於103年7月1  
24 日受聘於被告易華公司擔任被告易華公司之總經理，並負責  
25 與原公司相同之職務內容，其為該領域之專業人士，且為被  
26 告蔡金保、夏志雄、林建一之上級主管，應認被告蔡金保、  
27 夏志雄、林建一以系爭專利戊為發明人為申請專利時，其即  
28 應知悉系爭專利戊請求項1之技術內容，與原欣寶公司所有  
29 技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊，屬於實質相  
30 同之創作，是被告李宛霞、蔡金保、夏志雄、林建一均知悉  
31 申請系爭專利戊之行為，將造成原告就技術文件C如附表二

01 編號3技術內容欄所示資訊遭公開而喪失秘密性，仍為系爭  
02 專利戊之申請及相關批核，顯屬有故意，且其等所為與被告  
03 黃梅雪前述侵害原告營業秘密之行為，均為原告受有損害之  
04 共同原因，自應成立共同侵權行為。

05 (4)至被告雖辯稱被告蔡金保、夏志雄、林建一申請系爭專利  
06 戊，並不需經由被告李宛霞同意或批核云云，然申請專利需  
07 花費相當之金額，且專利權取得後日後之維護、管理亦需要  
08 一定之人力與費用，依被告蔡金保等人於易華公司之職務，  
09 實難認其等得以獨自決定是否申請該等專利，又被告李宛霞  
10 既為被告蔡金保等人之上級主管，且擔任公司總經理之管理  
11 階層，當無可能對於公司申請專利毫不知情，並全權授權被  
12 告蔡金保等人處理，另被告未曾提出任何證據以證明上開辯  
13 解為實，即非有據。

14 (5)綜前，原告所有技術文件C如附表二編號3技術內容所示之資  
15 訊為其營業秘密，則被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志  
16 雄、林建一未經原告同意或授權，將原告前開營業秘密以申  
17 請系爭專利戊之方式公開於眾，自屬侵害原告就技術文件C  
18 如附表二編號3技術內容欄所示之營業秘密。

19 4.另原告雖以被告夏志雄列為系爭專利甲之發明人或創作人，  
20 而認其侵害原告所有技術文件A如附表二編號1-2技術內容欄  
21 所示之營業秘密；復以被告夏志雄、林建一列為系爭專利乙  
22 之發明人或創作人，而認其等侵害原告所有技術文件A如附  
23 表二編號1-3技術內容欄所示之營業秘密，然觀之原告所提  
24 蔡金保101年3月5日寄發關於技術文件A之電子郵件內容、技  
25 術文件A當時存取權限之公證書及所附之附圖58至79（見本  
26 院卷二第79頁、本院卷五第437頁至第447頁、第506頁至第5  
27 27頁），可知上開郵件收件者並無被告夏志雄、林建一，且  
28 依卷內證據資料，亦無從證明被告夏志雄、林建一當時任職  
29 欣寶公司就技術文件A有存取權限，原告復未提出被告夏志  
30 雄、林建一任職欣寶公司時知悉或接觸技術文件A之相關證  
31 據資料，及說明被告夏志雄、林建一於申請系爭專利甲、乙

01 時與被告蔡金保間存有共同侵權行為之事實及相關舉證，本  
02 院自無從僅憑被告夏志雄、林建一列為系爭專利甲、乙之發  
03 明人或創作人及上開電子郵件等資料而為其等不利之認定，  
04 是原告此部分主張，即非可採。

05 5.至被告黃嘉能部分，原告雖稱被告黃嘉能為易華公司代表  
06 人，至遲於105年8月25日檢調搜索扣押後，即知悉被告李宛  
07 霞涉及擅自重製原告營業秘密，仍同意並授權被告李宛霞等  
08 人將之用於易華公司申請專利，並以公開方式洩漏實質技術  
09 內容，屬於營業秘密法第10條第1項第2款規定侵害營業秘密  
10 之行為云云（見本院卷二第24頁至第26頁），然依原告所提  
11 臺灣高雄地方檢察署檢察官105年度偵字第22514號、107年  
12 度偵字第8952號起訴書（見本院卷一第51頁至第77頁），可  
13 知該偵查案件係以被告李宛霞等人因違反營業秘密法案件，  
14 經臺灣高雄地方檢察署檢察官偵查後，即於000年0月間提起  
15 公訴，原告委任之訴訟代理人則於000年0月12日收受該起訴  
16 書，是被告黃嘉能既非該案之被告，且基於偵查不公開原  
17 則，其是否得於105年8月25日檢調搜索扣押時，即知悉被告  
18 李宛霞等人擅自重製原告營業秘密為何，甚或得以確認該等  
19 營業秘密之技術內容，實非無疑。再者，被告易華公司雖於  
20 107、108年間有申請系爭專利甲至己之行為，然除系爭專利  
21 甲請求項13、系爭專利乙請求項1、系爭專利戊請求項1，與  
22 原告就技術文件A如附表二編號1-2至1-3技術內容欄所示之  
23 資訊、技術文件C如附表二編號3技術內容欄所示資訊有實質  
24 相同之情形外，其餘部分請求項均係透過被告易華公司自身  
25 技術或公開資訊所為申請，則被告黃嘉能主觀上認為被告易  
26 華公司得以申請系爭專利甲至己，亦難認與常情相違。此  
27 外，原告並未舉證證明被告黃嘉能明確知悉被告李宛霞等人  
28 侵害其上述營業秘密之事實，更未能舉證被告黃嘉能有何知  
29 悉或因重大過失而不知上開文件為營業秘密法第10條第1項  
30 第1款規定之營業秘密，而取得、使用或洩漏該營業秘密  
31 （即營業秘密法第10條第1項第2款構成要件）之事實，自無



01 從認定其有故意或過失侵害原告營業秘密之情事。是以，原  
02 告主張被告黃嘉能應與被告李宛霞等人連帶負損害賠償責  
03 任，應屬無據。

04 (四)末按法人對於其董事或其他有代表權之人，因執行職務所加  
05 於他人之損害，應與行為人連帶負損害賠償責任，民法第28  
06 條定有明文。所謂執行職務，凡在外觀上足認為機關之職務  
07 行為，及在社會觀念上，與職務行為有適當牽連關係之行為  
08 者，均屬之。故利用職務上之機會及與執行職務之時間或處  
09 所有密切關係之行為，其在客觀上足認為與執行職務有關，  
10 而不法侵害他人之權利者，即令係為自己利益所為之違法行  
11 為，亦應包括在內（最高法院107年度台上字第33號判決可  
12 參）。查被告李宛霞為被告易華公司之總經理，係執行並負  
13 責易華公司之實際營運，為該公司內部最高階之專業經理  
14 人，對外應屬該公司有代表權之人。被告李宛霞就以被告易  
15 華公司名義申請取得如系爭專利甲、乙、戊，核屬其本於總  
16 經理身分之執行職務所為，該行為既侵害原告所有技術文件  
17 A、C如附表二編號1-2至1-3、3所示技術內容，則被告易華  
18 公司自應負民法第28條之法人侵權責任。是以，原告主張被  
19 告易華公司應依民法第28條規定，就被告李宛霞前述應賠償  
20 金額與其負連帶賠償責任，當屬有據。至原告主張被告易華  
21 公司應依民法第28條規定與被告黃嘉能、黃梅雪連帶負擔損  
22 害賠償；及被告易華公司應依公司法第23條第2項規定與被  
23 告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪連帶負擔損害賠償部分，因其未  
24 能舉證證明被告黃嘉能有何不法侵害原告權利之行為，亦未  
25 說明被告黃梅雪何以符合公司董事或其他有代表權之人等事  
26 實或提出相關證據；又原告係認本件共同侵權行為人為系爭  
27 專利甲至己所列名之發明人或創作人與被告黃嘉能、李宛  
28 霞、黃梅雪（見本院卷六第384頁），則被告易華公司既非  
29 本件共同侵權行為者，被告黃嘉能、李宛霞、黃梅雪並無從  
30 依公司法第23條第2項規定與其連帶，與該條之構成要件實  
31 有不合，故原告此部分主張，均非可採。

01 五、綜上所述，技術文件A、C如附表二編號1-1至1-3、3技術內  
02 容欄所示資訊為原告所有之營業秘密。被告李宛霞、黃梅  
03 雪、蔡金保所為申請系爭專利甲、乙，分別共同侵害原告就  
04 技術文件A如附表二編號1-2至1-3技術內容欄所示之營業秘  
05 密；被告李宛霞、黃梅雪、蔡金保、夏志雄、林建一所為申  
06 請系爭專利戊，共同侵害原告就技術文件C如附表二編號3技  
07 術內容欄所示之營業秘密。從而，原告所為前述訴之聲明，  
08 需進一步審理，並以上開判斷為前提，爰先為中間判決如主  
09 文所示。

10 中 華 民 國 112 年 2 月 24 日

11 智慧財產第三庭

12 法 官 潘曉玫

13 以上正本係照原本作成。

14 不得獨立提起上訴。

15 中 華 民 國 112 年 2 月 24 日

16 書記官 李建毅

17 附表一：

18

編號	專利證書號	專利名稱	專利申請日 (西元)	專利公告日 (西元)	專利權期間 (西元)	登記專利 權人	登記發明人 創作人
1	I663522 號發 明專利 (系爭專利 甲)	印刷電路板佈 線校正系統	2018年11月2 0日	2019年6月21 日	2019年6月21日至203 8年11月19日	易華電子 股份有限 公司	蔡金保 夏志雄 黃信揚 蘇盈君
2	M582744 號新 型專利 (系爭專利 乙)	端部外擴的光 罩	2019年5月14 日	2019年8月21 日	2019年8月21日至202 9年5月13日	易華電子 股份有限 公司	蔡金保 林建一 夏志雄
3	I669042 號發 明專利 (系爭專利 丙)	軟性電路板	2018年7月11 日	2019年8月11 日	2019年8月11日至203 8年7月10日	易華電子 股份有限 公司	蔡金保 林建一 鄭佩芬 黃信揚
4	M582745 號新 型專利 (系爭專利 丁)	具有總跨距輔 助測量記號之 軟性電路板	2019年3月29 日	2019年8月21 日	2019年8月21日至202 9年3月28日	易華電子 股份有限 公司	蔡金保 鄭佩芬 夏志雄 林建一
5	M584427 號新 型專利	印刷電路板交 錯線路改善統	2019年7月4 日	2019年10月1 日	2019年10月1日至202 9年7月3日	易華電子 股份有限 公司	蔡金保 黃信揚 夏志雄

01

	(系爭專利 戊)						林建一
6	M584428 號新 型專利 (系爭專利 已)	印刷電路板線 路強化系統	2019年7月4 日	2019年10月1 日	2019年10月1日至202 9年7月3日	易華電子 股份有限 公司	蔡金保 鄭佩芬 夏志雄 黃信揚

02

## 附表二：

03

編號	技術文件 名稱	技術內容 (與本案相關)	卷證出處
1	SIMPAL-AW11-Newetching (ET3) -8-Lowpressure-DEV-1-MEC-TST .xls		
1-1	同上	(附圖為營業秘密)	限閱卷(一) 第7頁、限 閱卷(二)第3 0頁
1-2	同上	(附圖為營業秘密)	限閱卷(一) 第12頁、 限閱卷(二) 第30頁
1-3	同上	(附圖為營業秘密)	限閱卷(一) 第12頁、 限閱卷(二) 第7頁
1-4	同上	(附圖為營業秘密)	限閱卷(一) 第8頁、限 閱卷(二)第3 2頁
2	SIMPAL23 0801SG-E X Alignm ent. ppt	(附圖為營業秘密)	限閱卷(一) 第65頁、 限閱卷(二) 第33頁
3	COF New Etching- G2 Photo Mask Des ign Rule	(附圖為營業秘密)	限閱卷(一) 第86頁、 第88頁、 限閱卷(二) 第34頁

4	產品的設計基準	(附圖為營業秘密)	限閱卷(一) 第128頁、 限閱卷(二) 第35頁
---	---------	-----------	------------------------------------